

股票代碼：8027



鈦昇科技股份有限公司

E&R ENGINEERING CORPORATION

2024 年度 年 報

年報查詢網址：<http://mops.twse.com.tw>

刊印日期：2025 年 04 月 30 日

一、本公司發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發言人姓名：林傑倫

職稱：行銷處處長

電話：〔07〕615-6600

電子郵件信箱：spokesman_8027@enr.com.tw

代理發言人姓名：張正彥

職稱：行銷處處長

電話：〔07〕615-6600

電子郵件信箱：spokesman_8027@enr.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司：高雄市燕巢區橫山路 61 號

電話：〔07〕615-6600

分公司：高雄市楠梓加工出口區東三街 6-2 號

電話：〔07〕364-7766

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市博愛路 17 號 3 樓

電話：〔02〕2381-6288

網址：<http://www.nsc.com.tw>

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

簽證會計師：謝仁耀會計師、李國銘會計師

事務所名稱：國富浩華聯合會計師事務所

地址：高雄市苓雅區四維三路 6 號 27 樓之 1

電話：〔07〕331-2133

網址：<http://www.crowehorwath.tw>

五、海外有價證券掛牌買賣交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：
不適用。

六、本公司網址：<http://www.enr.com.tw>

目 錄

壹、 致股東報告書	1
貳、 公司治理報告	5
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	5
二、最近年度支付董事（含獨立董事）、監察人、總經理及副總經理之酬金	12
三、公司治理運作情形	19
四、簽證會計師公費資訊	47
五、更換會計師資訊	47
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內 曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之資訊	48
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超 過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	48
八、持股比例佔前十名之股東，其相互間之關係之資訊	49
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對 同一轉投資事業之持股數合併計算綜合持股比例	49
參、 募資情形	
一、資本及股份	50
二、公司債(含海外公司債)辦理情形	55
三、特別股辦理情形	58
四、海外存託憑證辦理情形	58
五、員工認股權憑證辦理情形	58
六、限制員工權利新股辦理情形	60
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	60
八、資金運用計畫執行情形	60
肆、 營運概況	
一、業務內容	61
二、市場及產銷概況	71
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	77
四、環保支出情形	77
五、勞資關係	77
六、資通安全管理	79
七、重要契約	80
伍、 財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項	

一、財務狀況	82
二、財務績效	82
三、現金流量	83
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	84
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	84
六、風險事項分析評估	85
七、其他重要事項	88
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料	89
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	89
三、其他必要補充說明事項	89
四、最近年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第 36 條第 2 項第 2 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	89

壹、致股東報告書

鈦昇科技股份有限公司 2024 年度營業報告書

各位股東，大家好：

首先，感謝各位股東長期來對本集團的支持與鼓勵，茲就 2024 年度的營運成果及 2025 年度營業計畫簡要報告如下：

一、2024 年度營運結果

(一)營業計畫實施成果：

本集團在近年來，秉持雷射以及電漿技術核心，樹立了在 IC 封測業的技術領先地位。進而跨足更高階的雷射與電漿應用技術，除了在晶圓級封裝、系統級封裝等領域已開發高階設備，利用高階技術設備，也一舉跨足高階半導體封裝以及先進製程的行列。2024 年對於總體經濟角度而言，在各經濟體之間仍舊充滿不確定性，唯一可確定的是通膨議題仍舊維持高檔。地緣政治的快速變動，除了俄烏戰爭持續延宕之外，中東地區在 2024 年也發生了新一波的戰爭事件。在這些動盪的議題變化，我們確實看到全球經濟仍舊處於不穩定狀態，進而影響到電子產業的投資意願仍舊保守，也造成電子產業生態鏈上中下游，發生大規模的虧損以及裁員現象。不過，2024 年在全球的經濟活動中，卻仍有 AI 產業鏈相對強勢而一枝獨秀，成為全球經濟成長的重要動能。根據 Precedence Research 報告指出，2024 的人工智慧經濟規模已達 6,382 億美元，較 2023 成長 18.6%，至今仍持續增長。本集團在這幾年已投入相對多的資源開發高階技術與設備產品，以因應地緣政治的影響以及景氣循環的變化，並且積極的開拓人工智慧相關應用的領域。除此之外亦積極扮演新技術火車頭的角色，與產業先進相互結盟，建立新市場的業務開發平台，繼而跨足下一代技術開發話語權。綜上所述本集團 2024 年合併營業收入為新台幣 1,644,908 仟元，較 2023 年合併營業收入新台幣 1,549,374 仟元，成長約 6.17%；本年度歸屬於母公司之稅後淨損為 51,125 仟元，每股稅後淨損為 0.51 元。

(二)預算執行情形：

本集團編制預算係供內部經營管理之用，並未公告財務預測。

(三)集團財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

項 目		2024 年度	2023 年度
財務 收支	營業收入	1,644,908	1,549,374
	營業毛利	597,644	614,281
	稅後淨利(損)	(58,859)	23,575
獲利 能力	資產報酬率(%)	(0.92)	0.83
	股東權益報酬率(%)	(2.27)	0.95
	營業(損)益佔實收資本比率(%)	(10.97)	1.71
	稅前(損)益佔實收資本比率(%)	(4.92)	3.89
	每股盈餘(元)	(0.51)	0.32

(四) 集團研究發展狀況：

單位：新台幣仟元

項 目	2024 年度	2023 年度
研發費用	252,464	207,420
營業收入	1,644,908	1,549,374
比率(%)	15	13

本集團不斷致力於半導體生產設備之研發，在雷射打印、雷射微加工及電漿微加工等設備上深耕多年，並持續獲得客戶信賴及採用。近年來研發重點如下：1.玻璃基板雷射改質應用。2.玻璃基板穿孔檢測設備。3.玻璃基板貼合與切割設備。4.晶圓級電漿切割技術。5.先進製程檢測分析應用。6.ABF 切割以及鑽孔應用。因應新技術的開發，本集團在研發組織的建置上，以建立專精人才庫為目標，提供給雷射跟電漿加工技術以及新的檢測設備產品更大能量。目前新的技術開發，已進入世界級的領先群，而雷射設備跟電漿設備在主要供應鏈中，除了已被認證為合格供應商，且已可應用於下一代的高速運算晶片製程，預計可帶來營業額增長。除此之外，持續因應不同客戶需求整合雷射、電漿，進行多角化整合經營，建立電漿切割代工業務，並致力於產業多樣化及產品多樣化發展，達成業務擴充及毛利增長之方向。

二、2025 年度營業計畫概要

(一)經營方針

本集團以誠信務實、永續經營、持續創新、利潤共享、創造股東及員工價值極大化之經營理念，積極拓展新興市場，主動積極提升品質，以求新突破與創造價值之品質政策，積極強化品質之改善及客戶之滿意度，達成卓越企業之目標。

(二)預期銷售數量及其依據

銷售數量係依據市場需求狀況與發展趨勢、客戶營運概況及本集團目前接單情形，並參酌本集團之產能規模而訂定。2024 年在半導體產業在 AI 的議題之下，高階技術的市場需求仍舊居於領先地位，帶領整個電子產業以 AI 的浪潮，繼續抗

衡傳統產業萎縮以及總體經濟發展的不確定性。因此，高階半導體等相關設備投資續增加，先進製程市場規模持續擴大，除了車用電子在 2024 年需求減緩之外，大陸市場的內卷狀況短期內仍舊無法消彌，造成部分的成長停滯。2025 年雖說 AI 以及新技術的需求仍創新高，但是卻也面對大國博弈所衍生的關稅議題，雖說景氣逐漸緩解，但延續著地緣政治的因素存在，挑戰仍然艱巨。本集團已完成多項的新技術專案開發，2024 年開始將業務觸角往不同市場開發，今年已逐一落實預定的目標。本集團持續研發次世代快速雷射應用模組，應用在高階玻璃基板材料的量產，繼而持續開發玻璃基板在基板產業鏈的兩產技術。對於面板級封裝設備，本集團仍持續投入研發資源，在整廠產線提供多站點的電漿以及雷射設備，並且仍持續開發新的客戶。除此之外，本集團近年來引進不少國內外博士級人才，積極投入研發和發展更先進的半導體封測雷射精微加工技術，現今已獲得為數不少的專利，整合雷射與電漿應用技術提供客戶完整的解決方案，對未來 5G、Micro Led、高階玻璃載板、超速電腦和電動汽車等領域能有進一步的發展。

(三)重要之產銷政策

- 1.行銷研發方面，在下世代的玻璃基板應用上，本集團的量產技術處於領先地位，今年的行銷推廣重點，除了開展玻璃基板產業聯盟技術，也積極開拓玻璃基板的客戶群。對於高階面板級封裝技術，本集團將秉持著最佳技術供應夥伴的角色，持續跟著客戶腳步邁進。因應日本對於半導體市場的回歸，2024 年開始，已將營業觸角佈局到日本，開拓新的客群。除了將原有產品增加新行銷地區推銷，其次，也開發適合新客戶的產品應用，增加本集團行銷的韌性。
- 2.生產方面，本集團除持續發展精微雷射加工技術及精密電漿表面處理技術，也致力於新產品之研發。今年的生產基地增加了江蘇南通廠，對於建立大陸客戶的採購信任度之外，亦可以強化集團在品牌上的競爭價值，也能減少成本的增加，對客戶產生的生產的優勢效益，並以提高產品的競爭力。

三、未來公司發展策略

- (一)掌握市場動向，對於新世代的技術以及產品開發，結合潛力客戶積極進行共同開發工作，除了既有技術研發精進之外，更結合客戶的未來需求，提早一步縮短其產品開發的時程。
- (二)開拓新的地區銷售網絡，建立適當國際銷售通路及代理商銷售支援體系，充分與貿易夥伴合作，就近且迅速提供客戶最佳解決方案，以提升市場佔有率、擴大市場規模。
- (三)人才透過建教合作、參與高階人才培訓計畫，及申請替代役等方式擴大人才網羅之管道。此外，加強人才之專業培訓，密切與研究機構和學術機構交流。
- (四)持續研發改善生產技術、降低成本，以公司現有規模為基礎，研發多元性與高毛利產品，並將核心領域向不同產業延伸持續研發新設備，保持競爭優勢之領先。
- (五)因應集團未來發展之需，充分利用資本市場，降低資金成本，發揮最大資金運用效益。
- (六)因應集團擴展之需，橋頭科學園區廠房已於 2024 年動土、江蘇南通廠也於 2024 年中開幕啟用，對於設備產品的產能預備更多擴充空間，特別是對於高階產品的組

裝製作。另一方面，新的廠房也提供新的電漿加工業務，增加營運多元化的挹注。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響

- (一)最近年度國內外重要政策及法律變動對本集團財務業務並無重大影響，未來亦隨時取得相關資訊，並即時研擬必要因應措施以符合集團營運需要。
- (二)在面對產業環境的快速變遷，本集團透過政府提供的科技專案與A+計畫獲得不少幫助，進而協助延攬優秀人才，投入研發與創新，並尋求內部組織改造，透過教育培訓與組織改造，培育出高創意的研發管理團隊，全面提升核心競爭力，並積極開創具潛力之產品，以期擴大營業業績及獲利目標。
- (三)面對高速傳輸世代的來臨，新世代的玻璃基板以及面板封裝，在半導體產業對於雷射以及電漿的需求也愈來愈多，異質整合的複雜度對於雷射與電漿而言，將會是下一代半導體設備產業的核心應用，成為必要而不可或缺的一環，本集團多元化的技術開發，這幾年已備齊相關應用產品，除了核心應用設備之外，也已具備產業整合能力。
- (四)持續建置更完整的資訊安全系統。
- (五)全球極端氣候頻傳，嚴重衝擊人類生活及企業營運，氣候變遷同時會帶來轉型面的風險，如法規變動、市場改變、新技術需求等、亦會對企業未來持續營運帶來衝擊及變數。本集團持續發展 ESG 永續經營，無論在環境保護、社會責任及公司治理方面均責無旁貸。

在此衷心企盼全體股東持續給予鈦昇支持與鼓勵，繼續給予鈦昇熱心與懇切的指教，最後，鈦昇謹祝各位股東身體健康萬事如意！

董事長：王明慶



總經理：張光明



會計主管：曹瑞龍



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料

1. 董事資料

2025年4月14日；單位：股

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	王明慶	男 61~70歲	2023.06.21	3年	1994.10.24	2,697,811	4.13	4,200,334	3.87	—	—	822,956	0.78	中原大學機械系畢 屹偉企業(股)公司董事長	本公司董事長兼策略長 鈦昇半導體材料有限公司董事 唐威科技(股)公司董事	—	—	—	—
副董事長	中華民國	陳坤山	男 71~80歲	2023.06.21	3年	1994.10.24	897,903	1.38	949,428	0.88	224,382	0.21	—	—	逢甲大學機械系畢 本公司總經理 台灣飛利浦建元電子(股)公司	本公司副董事長兼技術長 唐威科技(股)公司監察人 鈦昇半導體材料有限公司董事 無錫鈦升半導體材料科技有限公司法人代表 東莞鈦升半導體材料有限公司法人代表 江蘇鈦昇科技有限公司法人代表	—	—	—	—
董事	中華民國	張光明	男 61~70歲	2023.06.21	3年	2002.06.21	798,620	1.22	1,059,661	0.98	11,664	0.01	—	—	清華大學工業工程系畢 台灣大學商研所畢 本公司執行副總經理 白砂電機(股)公司經理	本公司總經理兼執行長 唐威科技(股)公司董事長 鈦昇半導體材料有限公司總經理 東莞鈦升半導體材料有限公司董事 無錫鈦升半導體材料科技有限公司董事 江蘇鈦昇科技有限公司董事 博磊科技(股)公司獨立董事 翔緯光電(股)公司法人董事之代表人	—	—	—	—
董事	中華民國	東聯投資股份有限公司	—	2023.06.21	3年	2017.06.20	1,484,431	2.27	769,650	0.71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		代表人： 侯榮顯	男 61~70歲	2023.06.21		2020.06.18	—	—	—	—	4,422	0.00	—	—	國立成功大學會計研究所畢 安永聯合會計師事務所合夥人暨高雄所所長	侯榮顯會計師事務所所長 家庭樹有限公司負責人	—	—	—	—

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註		
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			股數	持股比率	職稱		姓名	關係
董事	中華民國	黃將庭	男 51~60歲	2023.06.21	3年	2020.06.18	1,034,288	1.27	1,216,680	1.12	—	—	—	—	侯榮顯會計師事務所所長 家庭樹有限公司負責人	嘉威生活股份有限公司法人董事 代表人 堤維西交通工業股份有限公司獨立董事 吉源控(股)有限公司獨立董事 統懋半導體股份有限公司獨立董事 聯合光纖通信股份有限公司獨立董事	—	—	—	—		
董事	中華民國	薛光菽	男 61~70歲	2023.06.21	3年	2020.06.18	444,657	0.55	447,333	0.41	116,110	0.11	—	—	台灣大學經濟系畢 復華投信業務協理 科隆國際生物科技業務副總	本公司營運總管理處副總經理 江蘇鈦昇科技有限公司董事 金太越科技股份有限公司董事 金太越(越南)科技股份有限公司董事	—	—	—	—		
獨立董事	中華民國	呂植富	男 61~70歲	2023.06.21	3年	2017.06.20	—	—	—	—	1,040	0.00	—	—	國立清華大學材料系畢 台灣飛利浦建元電子股份有限公司高雄廠廠長 國巨股份有限公司品質長兼楠梓分公司負責人	無	—	—	—	—		
獨立董事	中華民國	高坤勇	男 51~60歲	2023.06.21	3年	2020.06.18	—	—	—	—	—	—	—	—	台灣大學商學研究所畢 有木股份有限公司董事長 杰力科技(股)公司董事 巨盛電子(股)公司董事 宇威資產管理(股)公司合夥人 瑞柯科技(股)公司營運長 中華開發金控資深協理 滾石唱片上海辦事處經理 福特六和(股)公司地區經理	鐳睿全球科技(股)公司董事	—	—	—	—		
獨立董事	中華民國	彭慎翔	男 51~60歲	2023.06.21	3年	2023.06.21	—	—	—	—	—	—	—	—	陽明交通大學生物科技博士生 陽明交通大學 EMBA 管理研究所畢 成功大學 生物醫學工程學研究所畢	漢民科技(股)公司 副總經理 漢民科技(上海)有限公司 總經理 漢民原醫(股)公司董事長暨總經理 為同科技(股)公司董事長 合盟精密工業(合肥)有限公司 董事長	—	—	—	—		

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
																怡忠科技股份有限公司法人董事之代表人 瑞鑫科技股份有限公司法人董事之代表人 社團法人台灣平坦化應用技術協會理事長 漢民科技(股)公司 CMP 處長				

註1:法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表一。

註2:請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如 41~50 歲或 51~60 歲。

註3:填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

註4:與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註5:公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

2.法人股東之主要股東：

2025年4月14日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
東驊投資有限公司	林泳辰(90%)、王明慶(10%)

3.法人股東之主要股東為法人者其主要股東：

2025年4月14日

法人名稱	法人股東之主要股東
—	—

4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
王明慶		現任本公司董事長兼策略長，具有豐富財務、業務及技術專業知識，亦未有公司法第30條各款之情事。	不適用	0
陳坤山		現任本公司副董事長兼技術長，具有豐富業務及技術專業知識與經驗，亦未有公司法第30條各款之情事。	不適用	0
張光明		現任本公司總經理，具有豐富財務、業務及機械方面專業知識與經驗，亦未有公司法第30條各款之情事。	不適用	1
東驊投資有限公司 代表人:侯榮顯		現任侯榮顯會計師事務所所長及家庭樹有限公司負責人，具會計師專業資格及相關執業經驗，亦未有公司法第30條各款之情事。	不適用	4
黃將庭		現任本公司副總經理，具有豐富財經方面專業知識，亦未有公司法第30條各款之情事。	不適用	0
薛光菽		曾任超越化學(股)公司董事長，具有豐富業務經驗，亦未有公司法第30條各款之情事。	不適用	0
呂植富		為本公司獨立董事、審計委員會成員及薪酬委員會召集人，曾任國巨股份有限公司品質長兼楠梓分公司負責人，具有豐富業務經驗，亦未有公司法第30條各款之情事。	1. 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定之獨立情形 2.最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額	0
高坤勇		為本公司獨立董事、審計委員會召集人及薪酬委員會成員，現任有朮股份有限公司董事長兼總經理，具有豐富財務與業務之知識與經驗，亦未有公司法第30條各款之情事。		0

彭慎翔	為本公司獨立董事、審計委員會成員及薪酬委員會成員，現任漢民科技(股)公司副總經理、漢民科技(上海)有限公司總經理、漢民原醫(股)公司董事長暨總經理、為同科技(股)公司董事長、合盟精密工業(合肥)有限公司董事長、社團法人台灣平坦化應用技術協會理事長，具有豐富業務之知識與經驗，亦未有公司法第 30 條各款之情事。		0
-----	---	--	---

註：本公司全體董事皆未有公司法第三十條各款情事。

5. 董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化：

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業皆確保董事會依照法令、公司章程或股東會決議行使職權。本公司董事會結構依據公司章程、發展規模及實際運作情形，設定董事席次為9人。

本公司女性董事席次未達三分之一，主要係因本屆董事年限未期滿，將於次屆董事改選時積極尋找具專業能力的女性董事人選，並持續推動性別多元化，逐步提升董事會中女性的比例，實現多元化治理目標。

本公司董事會成員考量其專業性及多元性，應普遍具備執行職務所必需之知識技能及素養，相關落實情形如下表：

董事姓名	多元化核心項目													
	基本條件						具備能力				專業背景			
	性別	國籍	兼任本公司員工	年齡(歲)			獨立董事年資	經營管理	領導決策	產業經歷	財務管理	技術科技	財務會計	商務行銷
				51~60	61~70	71~80								
王明慶	男	中華民國	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	
陳坤山	男	中華民國	✓			✓	✓	✓		✓			✓	
張光明	男	中華民國	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
東驛投資有限公司 代表人:侯榮顯	男	中華民國			✓		✓	✓		✓		✓	✓	
黃將庭	男	中華民國	✓	✓			✓			✓		✓	✓	
薛光菽	男	中華民國			✓		✓	✓	✓				✓	
呂植富	男	中華民國			✓		6	✓	✓	✓		✓	✓	
高坤勇	男	中華民國		✓			3	✓	✓	✓	✓		✓	
彭慎翔	男	中華民國		✓			1	✓	✓	✓		✓	✓	

(2) 董事會獨立性：

依證券交易法規定，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，並由全體獨立董事組成審計委員會；本公司為公司整體營運政策考量，本公司董事會由9席董事組成，現有3席獨立董事，佔全體董事席次30%，已符合應設置獨立董事席次及佔全體董事席次比重之規定。本公司之董事會指導公司營運策略、監督並評估經營團隊績效，並對公司及股東負責，在公司治理制度之各項作業，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，本公司董事間全部席次皆未具有配偶或二親等以內親之關係，符合證券交易法第26條之3第3項規定。獨立行使職權，有關董事獨立性聲明，請參閱本年報二、(一).1及.4董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露之說明。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

2025年4月14日；單位：股

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	張光明	男	1998.08	1,059,661	1.00	11,664	0.01	—	—	清華大學工業工程系畢業 台灣大學商研所畢業 本公司執行副總經理 白砂電機(股)公司經理	本公司董事 唐威科技(股)公司董事長 鈦昇半導體材料有限公司總經理 東莞鈦升半導體材料有限公司董事 無錫鈦升半導體材料科技有限公司董事 江蘇鈦晟科技有限公司董事 博磊科技(股)公司獨立董事 翔緯光電(股)公司法人董事之代表人	無	無	無	—
技術長	中華民國	陳坤山	男	1997.12	949,428	0.90	224,382	0.21	—	—	逢甲大學機械系畢業 本公司總經理 台灣飛利浦建元電子(股)公司經理	本公司副董事長 唐威科技(股)公司監察人 鈦昇半導體材料有限公司董事 無錫鈦升半導體材料科技有限公司法人代表 東莞鈦升半導體材料有限公司法人代表 江蘇鈦晟科技有限公司法人代表	無	無	無	—
營運長	中華民國	趙偉克	男	1995.11	458,104	0.43	6,121	0.01	—	—	台灣科技大學機械系畢業 美阿拉巴馬大學工工碩士 台灣金豐業務專員	無	無	無	無	—
研發處副總經理	中華民國	葉錫銘	男	2021.01	24,500	0.02	—	—	—	—	清華大學原子科學系博士畢業 世禾科技股份有限公司研發協理	無	無	無	無	—
研發處副總經理	中華民國	朱育民	男	2016.01	38,000	0.04	—	—	—	—	成功大學電機系畢業 陞暘科技資深工程師	無	無	無	無	—
策略暨執行長	中華民國	黃將庭	男	2019.12	1,216,680	1.15	—	—	—	—	台灣大學經濟系畢業 復華投信業務協理 科隆國際生物科技業務副總	江蘇鈦晟科技有限公司董事 金太越科技股份有限公司董事 金太客(越南)科技股份有限公司董事	無	無	無	—

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
子公司總經理	中華民國	賴建宏	男	2015.09	80,846	0.08	—	—	—	—	南亞工專化工科畢 華泰電子(股)公司課長	辰鈦貿易(上海)有限公司法人代表 江蘇鈦晟科技有限公司總經理	無	無	無	—
業務技服處處長	中華民國	林傑倫	男	2019.11	10,500	0.01	—	—	—	—	逢甲大學經營管理研究所畢 南開技術大學電子工程系畢 新瑞光能(股)公司經理	無	無	無	—	
業務技服處處長	中華民國	張正彥	男	2024.06	15,750	0.03	—	—	—	—	美國 Hult 霍特國際商學院-倫敦校區研究所畢 元智大學資訊傳播學系畢 順泰電子科技公司 US&EMEA 海外業務代表 日月光高雄廠美洲組資深運籌管理師	無	無	無	—	
研發處處長	中華民國	洪詳峻	男	2025.01	0.00	0.00	—	—	—	—	德國阿亨工業大學(德國)物理研究所畢 晶元光電股份有限公司協理	無	無	無	—	
會計主管/公司治理主管	中華民國	曹瑞龍	男	2008.06	3,000	0.00	—	—	—	—	成功大學財務金融研究所畢 景岳生物科技(股)公司會計課長 眾信聯合會計師事務所審計領組	無	無	無	—	
財務主管	中華民國	盧佳慧	女	2020.04	4,500	0.00	—	—	—	—	高雄科技大學國際企業研究所畢 華亞科技(股)公司課長 好奇股份有限公司副課長	無	無	無	—	

(三) 董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人，互為配偶或一等親親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：不適用。

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司依據公司章程規定之比率及範圍給付董事、總經理及副總經理酬金且參酌該職位於同業市場中的薪資水平、職位的權責範圍以及對公司營運目標達成的貢獻度給付酬金。訂定酬金之程序，除了參考公司整體的營運績效，亦參考個人的績效達成情形及對公司績效的貢獻度，而給予合理的報酬。
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無此情事。
3. 依本公司公司章程規定，本公司董事長、副董事長及董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度、貢獻之價值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。公司章程中亦明訂不高於年度獲利的3%作為董事酬勞，且給付之對象不包括獨立董事。依本公司給付原則如下：(1) 獨立董事不參與董事酬勞之分配；(2) 因所有獨立董事皆擔任審計暨薪酬委員會，參與相關委員會會議之討論及決議，故其領取固定之薪酬且業務執行費用略高於一般董事；(3) 因董事長不配發員工酬勞，因此其董事酬勞略高於一般董事。
4. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無此情形。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內 所有公司 I	本公司	財務報告內 所有公司 J
低於1,000,000元	王明慶、陳坤山、張光明、黃將庭、侯榮顯、薛光菽、呂植富、高坤勇	王明慶、陳坤山、張光明、黃將庭、侯榮顯、薛光菽、呂植富、高坤勇	侯榮顯、薛光菽、呂植富、高坤勇	侯榮顯、薛光菽、呂植富、高坤勇
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	—	—	黃將庭	黃將庭
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	—	—	王明慶、陳坤山、張光明	王明慶、陳坤山、張光明
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	—	—	—	—
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	—	—	—	—
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	—	—	—	—
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	—	—	—	—
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	—	—	—	—
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	—	—	—	—
100,000,000元以上	—	—	—	—
總計	9人	9人	9人	9人

註 1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及「總經理及副總經理之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)表」或「總經理及副總經理之酬金(配合彙總級距揭露姓名方式)表」。

註 2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。

註 4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS

2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列附表「配發員工紅利之經理人姓名及配發情形」。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註10：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

2.監察人之酬金：不適用，本公司已於2020.06.18已設置審計委員會取代監察人。

3. 總經理及副總經理之酬金

2024年12月31日;單位:新臺幣仟元;仟股

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司外轉投資或酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理兼執行長	張光明	18,712	19,706	734	734	6,026	6,026	299	—	299	—	-50.99	-89.62	無
技術長	陳坤山													
營運長	趙偉克													
副總經理	葉錫銘													
副總經理	朱育民													
子公司總經理	賴建宏													
策略暨投資長	黃將庭													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	—	—
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	黃將庭、賴建宏、葉錫銘、朱育民	黃將庭、賴建宏、葉錫銘、朱育民
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	陳坤山、張光明、趙偉克	陳坤山、張光明、趙偉克
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	—	—
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	—	—
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	—	—

15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	—	—
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	—	—
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	—	—
100,000,000元以上	—	—
總計	8人	8人

*不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者，均應予揭露。

註1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(1)

註2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、退職退休金、離職金。

註3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註4：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數。其股票紅利金額上市上櫃公司應以證券發行人財務報告編製準則規定公平價值（係指資產負債表日之收盤價）計算之；若非上市上櫃公司則以盈餘所屬年度會計期間結束日之淨值計算之。稅後純益係指最近年度之稅後純益。

註5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註8：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註9：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表E欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

4.前五位酬金最高主管之酬金：不適用。

5. 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形：

2024年12月31日;單位：新臺幣仟元

經理人	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比率
	總經理兼執行長	張光明	—	416	416	-0.81%
	技術長	陳坤山				
	營運長	趙偉克				
	研發處副總經理	朱育民				
	研發處副總經理	葉錫銘				
	策略暨投資長	黃將庭				
	子公司總經理	賴建宏				
	業務技服處長	林傑倫				
	業務技服處長	張正彥				
	會計主管	曹瑞龍				
	財務主管	盧佳慧				

註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。

註2：係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利)，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註3：經理人之適用範圍，依據本會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定，其範圍如下：

- (1)總經理及相當等級者
- (2)副總經理及相當等級者
- (3)協理及相當等級者
- (4)財務部門主管
- (5)會計部門主管
- (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者，除填列附表「酬金揭露方式」外，另應再填列本表。

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性

1.本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析：

項目	年度	酬金總額占稅後純益比例			
		2023 年度		2024 年度	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事酬金		70.83%	75.33%	-3.65%	-3.65%
總經理及副總經理酬金		98.49%	98.80%	-50.99%	-89.62%

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司依據公司章程規定之比率及範圍給付董事、監察人、總經理及副總經理酬金且參酌該職位於同業市場中的薪資水平、職位的權責範圍以及對公司營運目標達成的貢獻度給付酬金。訂定酬金之程序，除了參考公司整體的營運績效，亦參考個人的績效達成情形及對公司績效的貢獻度，而給予合理的報酬。

本公司經理人的薪酬包含月薪與各項獎金制度、退休制度及考核制度皆經薪酬委員會同意通過，並提請董事會決議後據以執行。高階經理人的薪資調整、獎金及其他報酬，依公司經營績效、個人績效與貢獻度，並納入經濟、環境及社會三個面向的貢獻與表現等永續發展的公司治理指標，且參酌業界薪酬水準，由人資單位草擬建議案後向薪酬委員會報告，經委員會檢討審議後再呈報董事會決議後執行。總經理及副總經理等經理人酬金給付，係依據公司規定辦理，包含固定薪酬如固定月薪、各項職務津貼、年終獎金，並依本公司「退休辦法」每月提撥退休金（含新、舊制退休金）、福利金等，另變動薪酬如於特殊情形依公司留任措施及營運達成績效支給之績效獎金、員工酬勞、員工認股權與庫藏股...等薪酬，其與經營績效具有正向關聯性，並依據法令規定揭露給付金額，未來風險應屬有限。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形:

最近年度(2024 年度)為 5 次及 2025 年度截至年報刊印日止為 3 次，董事會共召 8 次(A)。董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【(B)/(A)】(註2)	備註
董事長	王明慶	6	2	75	2023年6月21日連任
副董事長	陳坤山	8	—	100	2023年6月21日連任
董事	張光明	8	—	100	2023年6月21日連任
法人董事	東驊投資有限公司 代表人：侯榮顯	8	—	100	2023年6月21日連任
董事	黃將庭	8	—	100	2023年6月21日連任
董事	薛光菽	8	—	100	2023年6月21日連任
獨立董事	呂植富	8	—	100	2023年6月21日連任
獨立董事	高坤勇	8	—	100	2023年6月21日連任
獨立董事	彭慎翔	8	—	100	2023年6月21日新任

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：董事會重要決議如下表，並無獨立董事反對或有保留意見之情形。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

(一)2024年03月06日董事會議

1.由於陳坤山董事、張光明董事及黃將庭董事分別擔任本公司高階經理人，案由三與其獎金報酬相關，故依法進行利益迴避；由於張光明董事、黃將庭董事及侯榮顯董事分別為案由六之當事人，故依法進行利益迴避。

2.議案內容：

(1)案由三：本公司 2023 年經理人發放績效獎金討論案。

(2)案由六：本公司擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.該案由除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經主席徵詢其餘未迴避之出席董事意見，無異議照案通過。

(二)2024年05月08日董事會議

1.由於陳坤山董事、張光明董事及黃將庭董事分別擔任本公司高階經理人，案由一~案由二與其獎金報酬相關，故依法進行利益迴避。

2.議案內容：

(1)案由一：本公司2023年度員工酬勞分配案。

(2)案由二：本公司2024年經理人發放績效獎金討論案。

3.該案由除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經主席徵詢其餘未迴避之出席董事意見，無異議照案通過2023年03月07日董事會議

(三)2024年11月06日董事會議

1.由於王明慶董事、陳坤山董事、張光明董事及黃將庭董事分別擔任本公司高階經理人，案由一~三與其獎金報酬相關，依法進行利益迴避，由主席王明慶董事長指派獨立董事呂植富先生擔任此案之代理主席。由於出席之張光明董事為案由十七之當事人，依法進行利益迴避。

2.議案內容：

(1)案由一：本公司2024年經理人發放績效獎金討論案。

(2)案由二：本公司2024年度經理人年終獎金討論案。

(3)案由三：本公司2025年度經理人薪酬調整案。

(4)案由十七：本公司擬通過執行長任命案。

3.該案由除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經主席徵詢其餘未迴避之出席董事意見，無異議照案通過。

(四)2025年03月06日董事會議

1.由於陳坤山董事、張光明董事及黃將庭董事分別擔任本公司高階經理人，案由二與其獎金報酬相關，依法進行利益迴避。

2.議案內容：

(1)案由二：本公司2024年經理人發放績效獎金討論案。

3.該案由除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經主席徵詢其餘未迴避之出席董事意見，無異議照案通過。

(五)2025年04月25日董事會議

1.由於高坤勇獨立董事擔任案由四之被投資公司董事長，依法須進行利益迴避；由於張光明董事擔任案由六交易對象之獨立董事，依法進行利益迴避。

2.議案內容：

(1)案由四：本公司擬通過「雷大光電股份有限公司」增資案。

(2)本公司擬取消原代江蘇鈦晟半導體科技有限公司出售部分廠房案。

3.本案除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經主席徵詢其餘未迴避之出席董事與獨立董事意見，無異議照案通過。

三、董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

本公司已於2024年辦理董事會評鑑，並於2025年揭露評鑑執行情形。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次，業經2025年03月06日董事會通過在案。	2024年1月1日~12月31日	1.董事會整體績效 2.董事會成員績效 3.審計委員會績效 4.薪資報酬委員會	1.董事會自評 2.董事會成員自評 3.審計委員會績效 4.薪資報酬委員會	1.董事會整體績效評估之項目： (1)對公司營運之參與程度。 (2)提升董事會決策品質。 (3)董事會組成與結構。 (4)董事之選任及持續進修。 (5)內部控制。 2.董事會成員績效評估之項目： (1)公司目標與任務之掌握。 (2)董事職責認知。 (3)對公司營運之參與程度。 (4)內部關係經營與溝通。

					(5)董事之專業及持續進修。 (6)內部控制。 3. 審計委員會績效評估之項目： (1)對公司營運之參與程度。 (2)功能性委員會職責認知。 (3)提升功能性委員會決策品質。 (4)功能性委員會組成及成員選任。 (5)內部控制。 4. 薪資報酬委員會績效評估之項目： (1)對公司營運之參與程度。 (2)功能性委員會職責認知。 (3)提升功能性委員會決策品質。 (4)功能性委員會組成及成員選任。 (5)內部控制。
--	--	--	--	--	--

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：

(一)加強董事會職能

1. 本公司依「公開發行公司董事會議事辦法」規定，訂定本公司「董事會議事規範」，並依相關規定進行董事會職能運作。
2. 本公司本屆董事會成員於上年度均已參加上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點所指定機構舉辦之公司治理相關進修課程，本年度也將持續提供上課資訊與安排進修事宜。
3. 本公司已設置獨立董事，均以其專業知識等能力，就公司有關內部控制制度執行、業務及財務等相關議案，提供董事會相關建議。
4. 本公司已於2020年股東常會選任第十屆董事起，設置三席獨立董事，並組成審計委員會，以加強董事會職能。
5. 會計師不定期列席審計委員會，並與審計委員就財務報告、公司治理與相關法令...等討論與溝通。
6. 增加董事會成員與經營團隊交流，除了董事會議之外，亦增加座談會與邀請董事參加公司重要活動，如：新建廠房之動土儀式、已驗收廠房之落成典禮...等。

(二)提升資訊透明度

本公司財務報表委託國富浩華聯合會計師事務所定期核閱或查核簽證，對於法令所要求之各項資訊能正確且及時完成，並有專責人員負責公司各項資訊之搜集，依規定定期於公開資訊觀測站申報及揭露各項應公告資訊，並定期更新公司官網上的資訊以利本公司利害關係人能更了解公司。此外，本公司已建立發言人與代理發言人制度，以確保各項重大資訊能及時且允當揭露。

註1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

本公司證券交易法第 14 條之 3 所列事項

董事會日期	重要決議
2024 年 03 月 06 日 (第十一屆第五次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2023 年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司 2023 年度盈餘分配表案。 3. 本公司擬對轉投資公司「江蘇鈦昇科技有限公司」新增資金貸與案。 4. 本公司轉投資公司「江蘇鈦昇科技有限公司」擬對轉投資公司「辰鈦(上海)貿易有限公司」新增資金貸與案。 5. 本公司擬對轉投資公司「無錫鈦升半導體材料科技有限公司」新增資金貸與案。 6. 公司基於經營業務之避險需要，擬預購或預售、換匯換利及匯率交換所需之外幣案。 7. 本公司「內部控制制度聲明書」承認案。
2024 年 05 月 08 日 (第十一屆第六次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2024 年第 1 季合併財務報表案。 2. 本公司配合國富浩華聯合會計師事務所內部調整更換會計師案。 3. 本公司擬對轉投資公司「江蘇鈦昇科技有限公司」新增資金貸與案。 4. 本公司擬對轉投資公司「無錫鈦升半導體材料科技有限公司」新增資金貸與案。
2024 年 08 月 07 日 (第十一屆第七次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬通過 2024 年第 2 季合併財務報表案。 2. 本公司擬對孫公司「無錫鈦升半導體材料科技有限公司」新增資金貸與案。
2024 年 11 月 06 日 (第十一屆第八次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2024 年第 3 季合併財務報表案。 2. 本公司擬提供轉投資公司「唐威科技股份有限公司」背書保證追認案。 3. 本公司擬對孫公司「無錫鈦升半導體材料科技有限公司」新增資金貸與案。 4. 本公司擬對轉投資公司「江蘇鈦晟半導體科技有限公司」新增資金貸與案。 5. 本公司擬通過「內部控制制度」修訂案。 6. 本公司擬通過 2025 年度稽核計畫案。
2024 年 12 月 25 日 (第十一屆第九次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬對轉投資公司「江蘇鈦晟半導體科技有限公司」新增資金貸與案。
2025 年 03 月 06 日 (第十一屆第十次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬修訂「公司章程」部分條文討論案。 2. 本公司 2024 年度營業報告書及財務報表案。 3. 本公司 2024 年度盈虧撥補表案。 4. 本公司擬對轉投資公司「江蘇鈦晟半導體科技有限公司」新增資金貸與案。 5. 本公司擬對轉投資公司「無錫鈦升半導體材料科技有限公司」及「江蘇鈦晟半導體科技有限公司」新增資金貸與案。 6. 本公司「內部控制制度聲明書」承認案。 7. 本公司擬通過「內部控制制度」修訂案。
2025 年 04 月 25 日 (第十一屆第十二次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬通過 2025 年第 1 季合併財務報表案。 2. 本公司擬對轉投資公司「江蘇鈦晟半導體科技有限公司」新增資金貸與案。 3. 本公司擬對轉投資公司「無錫鈦升半導體材料科技有限公司」新增資金貸與案。 4. 本公司擬取消原代江蘇鈦晟半導體科技有限公司出售部分廠房案。

(二) 審計委員會運作情形資訊、監察人參與董事會運作情形

1. 審計委員會運作情形資訊：

最近(2024)年度審計委員會開會 5 次及 2025 年度截至年報刊印日止為 1 次，審計委員會共召開 6 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) 【(B)/(A)】(註)	備註
獨立董事	呂植富	6	—	100	2023年6月21日連任
獨立董事	高坤勇	6	—	100	2023年6月21日連任
獨立董事	彭慎翔	6		100	2023年6月21日新任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會日期及期別	議案內容	獨立董事意見及重大建議	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
2024.03.06 (第二屆第四次)	1.本公司2023年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司2023年度盈餘分配表案。 3.本公司擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 4.本公司擬對轉投資公司「江蘇鈦昇科技有限公司」新增資金貸與案。 5.本公司轉投資公司「江蘇鈦昇科技有限公司」擬對轉投資公司「辰鈦(上海)貿易有限公司」新增資金貸與案。 6.本公司擬對轉投資公司「無錫鈦升半導體材料科技有限公司」新增資金貸與案。 7.公司基於經營業務之避險需要,擬預購或預售、換匯換利及匯率交換所需之外幣案。 8.本公司擬通過「金太越科技股份有限公司」投資案。 9.本公司「內部控制制度聲明書」承認案。	無	審計委員會全體成員同意通過。	無
2024.05.08 (第二屆第五次)	1.本公司2024年第1季合併財務報表案。 2.本公司配合國富浩華聯合會計師事務所內部調整更換會計師案。 3.本公司擬對轉投資公司「江蘇鈦昇科技有限公司」新增資金貸與案。 4.本公司擬對轉投資公司「無錫鈦升半導體材料科技有限公司」新增資金貸與案。 5.本公司擬通過「欣鉅興科技股份有限公司」投資案。	無	審計委員會全體成員同意通過。	無
2024.08.07 (第二屆第六次)	1.本公司擬通過2024年第2季合併財務報表案。 2.本公司擬對孫公司「無錫鈦升半導體材料科技有限公司」新增資金貸與案。	無	審計委員會全體成員同意通過。	無
2024.11.06 (第二屆第七次)	1.本公司2024年第3季合併財務報表案。 2.本公司擬提供轉投資公司「唐威科技股份有限公司」背書保證追認案。 3.本公司擬對孫公司「無錫鈦升半導體材料科技有限公司」新增資金貸與案。 4.本公司擬對轉投資公司「江蘇鈦晟半導體科技有限公司」新增資金貸與案。 5.本公司「內部控制制度」修訂案。 6.本公司擬通過2025年度稽核計畫案。	無	審計委員會全體成員同意通過。	無

審計委員會日期及期別	議案內容	獨立董事意見及重大建議	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
2024.12.25 (第二屆第八次)	1.本公司擬對轉投資公司「江蘇鈦晟半導體科技有限公司」新增資金貸與案。	無	審計委員會全體成員同意通過。	無
2025.03.06 (第二屆第九次)	1.本公司 2024 年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司 2024 年度盈虧撥補表案。 3.本公司擬對轉投資公司「江蘇鈦晟半導體科技有限公司」新增資金貸與案。 4.本公司擬對轉投資公司「無錫鈦升半導體材料科技有限公司」及「江蘇鈦晟半導體科技有限公司」新增資金貸與案。 5.本公司「內部控制制度聲明書」承認案。 6.本公司擬通過「內部控制制度」修訂案。	無	審計委員會全體成員同意通過。	無
2025.04.25 (第二屆第十次)	1.本公司擬通過 2025 年第 1 季合併財務報表案。 2.本公司擬對轉投資公司「江蘇鈦晟半導體科技有限公司」新增資金貸與案。 3.本公司擬對轉投資公司「無錫鈦升半導體材料科技有限公司」新增資金貸與案。	無	審計委員會全體成員同意通過。	無

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：

(一)每年獨立董事與內部稽核主管或會計師透過會議(不包括董事會)或座談，至少一次召開會計師或稽核主管單獨會議，就內部稽核報告或會計師查核報告進行溝通。

(二)內部稽核主管定期向審計委員會報告

1.年度內部稽核計畫；

2.內部稽核主管按月於稽核報告完成後，次月底前呈報各獨立董事，另依獨立董事意見強化查核重點。。

(三)會計師每半年皆參加審計委員會，報告年度查核結果。

(四)其他：發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
2024.03.06 審計委員會	獨立董事呂植富 獨立董事高坤勇 獨立董事彭慎翔 會計師 李青霖 稽核主管黃淨琦	1.會計師針對本公司 2023 年度個體及合併財務報告相關事項進行說明及溝通。 2.依據自行評估及內部稽核的結果，溝通本公司內部控制制度符合所有法令且無重大缺失。	無異議照案通過。
2024.11.06 審計委員會	獨立董事呂植富 獨立董事高坤勇 獨立董事彭慎翔 稽核主管黃淨琦	報告與溝通 2025 年度之稽核計畫。	無異議照案通過。
2025.03.06 審計委員會	獨立董事呂植富 獨立董事高坤勇 獨立董事彭慎翔 會計師 謝仁耀	1.會計師針對本公司 2023 年度個體及合併財務報告相關事項進行說明及溝通。 2.依據自行評估及內部稽核的	無異議照案通過。

	稽核主管黃淨琦	結果，溝通本公司內部控制制度符合所有法令且無重大缺失。	
--	---------	-----------------------------	--

四、公司是否定期評估簽證會計師獨立性：審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責，以確保財務報表的公正性。一般而言，除稅務相關服務或特別核准的項目外，簽證會計師事務所不得提供本公司其他服務。簽證會計師事務所提供的所有服務必需得到審計委員會的核准。為確保簽證會計師事務所的獨立性，審計委員會參考審計品質指標(AOIs)每年定期就會計師之獨立性、專業性及適任性評估，評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等項目。2025年03月06日第二屆第九次審計委員會及2025年03月06日第十一屆第十次董事會審議並通過國富浩華會計師事務所謝仁耀會計師及李國銘會計師均符合審計品質指標(AQIs)獨立性評估標準，足堪擔任本公司財務及稅務簽證會計師。

評估項目	是	否	說明
1. 非為公司或其關係企業之受僱人。	✓		經查會計師無此情形
2. 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接或間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。	✓		經查會計師無此情形
3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。	✓		經查會計師無此情形
4. 非前三款所列人員之配偶、二等親以內親屬或三等親以內直系血親親屬。	✓		經查會計師無此情形
5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。	✓		經查會計師無此情形
6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。	✓		經查會計師無此情形
7. 未與其他董事間具有配偶或二等親以內之親屬關係。	✓		經查會計師無此情形
8. 未有公司法第30條各款情事之一。	✓		經查會計師無此情形
9. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	✓		經查會計師無此情形
10. 是否取具受任會計師及審計小組所出具之「超然獨立聲明書」。	✓		已取得
◆經評估後，委任簽證會計師皆未有以上獨立性評估項目所述情事，可確認簽證會計師符合獨立性，出具之財務報告之可信賴度無虞。			

註：(1)年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

2.監察人參與董事會運作情形：本公司已於2020年06月18日設置審計委員會取代監察人，故不適用。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則?	✓		本公司訂有「公司治理守則」，針對保障股東權益、強化董事會職能、發揮功能性委員會之功能、尊重利害關係人權益、提昇資訊透明度皆有相關規範，守則內容請至本公司網站查詢。	符合公司治理實務守則規定。
二、公司股權結構及股東權益				
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施?	✓		(一)本公司已設置發言人、代理發言人及股務等單位專人處理股東建議、疑義或糾紛等問題。	符合公司治理實務守則規定。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單?	✓		(二)由專業股務代理機構負責，並設有專責人員處理相關事宜，可掌握實際控制公司之主要股東名單。	
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制?	✓		(三)管理權責均明確區隔。本公司已依法令於內部控制制度訂有相關制度且均確實執行外，稽核人員亦不定期監督執行情形。	
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券?	✓		(四)本公司已制定「防範內線交易管理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。明訂內部人於獲悉有重大影響本公司股票價格或重大影響其支付本息能力之消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後十八小時內、年度財務報告公告前三十日及每季財務報告公告前五日之封閉期間，不得對本公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票、其他具有股權性質之有價證券或非股權性質之公司債，自行或以他人名義買入或賣出。	
三、董事會之組成及職責				

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行?	✓		(一)本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷及資格外，並遵守「董事選舉辦法」，董事成員的選任標準應綜合考量個人的專業知識、經驗、商業判斷能力、堅守本公司核心價值的承諾及個人在道德行為及領導上的聲譽，並應審酌整體董事會成員背景的多元性（包含性別、年齡與文化）。	符合公司治理實務守則規定。
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，是否自願設置其他各類功能性委員會?		✓	(二)本公司已依法設置薪酬委員會以及審計委員會，除此之外尚無其他功能性委員會，未來將視需求設置其他各類功能性委員會。	
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考?	✓		(三)本公司已訂定績效評估辦法，並且每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會；每年之董事酬勞之發放，會參考個別董事之績效做為發放之依據。	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?	✓		(四)本公司為確保簽證會計師事務所的獨立性，審計委員會參考審計品質指標(AQIs)每年均定期評估就會計師之獨立性、專業性及適任性評估，評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等項目。目前本公司之簽證會計師與公司及董事均非關係人，其獨立性尚無疑慮。	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?	✓		本公司已配置公司治理主管，公司治理相關事務由其擔任，並由總經理負責督導。公司治理相關事務，包括下列內容： (一)依照法令公告申報公司相關資訊及重大事項。 (二)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜，並協助公司遵循董事會及股東會之相關法令。 (三)製作董事會及股東會議事錄。 (四)提供董事執行業務所需資料，以及經營公司有關之最新法規，以協助董事遵循法令。 (五)與投資人關係相關之事務。 (六)訂定與修訂公司章程及其他管理辦法。	符合公司治理實務守則規定。
五、公司是否建立與利害關係人人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	✓		本公司已於本公司網站設置投資人專區，並設立發言人及代理發言人，作為與利害關係人溝通之管道，且本公司設有專責人員處理相關問題。	符合公司治理實務守則規定。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	✓		本公司已委託永豐金證券股務代理部辦理股東會相關事務。	符合公司治理實務守則規定。
七、資訊公開				
(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊?	✓		(一)目前本公司財務業務及公司治理相關揭露事項，都依規定揭露於公開資訊觀測站，且本公司已架設網站，並對公司相關資訊進行不定期更新，以供投資人及社會大眾查詢。	符合公司治理實務守則規定。
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?	✓		(二)本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集，及將相關應揭露資訊於「公開資訊觀測站」與公司官網上揭露，並落實發言人制度，於平日配合公司政策及需要時，對外發佈訊息。	
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?	✓		(三)本公司皆於期限前或是期限內公告並申報財務報告，每月運情形大致於每月5日即公告，相關的季報與年報皆於董事會通過當天即發布重大訊息，董事會通過之日期皆盡可能早於規定期限一周以上。	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	✓		<p>(一)員工權益與僱員關懷 本公司與集團內各公司均致力於創造員工最佳福祉，建立人性化管理制度，隨時提供福利資訊，辦理教育訓練精進員工專業技能與職涯發展，設有福利委員會與舉辦各項活動促進員工交流。此外，更加強建立互動溝通及提供多元申訴管道。</p> <p>(二)投資者關係 本公司設有發言人與代理發言人制度，透過發言人及股東會與投資者溝通，並依法令透過公開資訊觀測站及公司網站充分揭露相關資訊，以保障投資人之權益。</p> <p>(三)供應商關係 本公司依平等互惠原則與供應商建立夥伴關係，建立穩定供應鏈，且不定期進行稽核以確認供應品質。</p> <p>(四)利害關係人權益 本公司與往來銀行及其他債權人、員工、客戶、供應商等相關利害關係人皆有暢通之溝通管道，並尊重其應有合法權益，並且在公司網站上設立利害關係人的聯絡方式，提供溝通管道。若設及法律問題，則委請專業律師或法律顧問進行處理，以維護利害關係人之權益。</p> <p>(五)董事之進修情形 本公司董事均具備相關專業知識，且依董事、監察人進修推行要點完成進修課程。本公司亦以積極態度鼓勵董事參與進修，且隨時提供董事相關的進修課程訊息予以參考，並協助報名相關進修課程。</p> <p>(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形 本公司訂有「內部控制制度」及相關管理辦法，每年皆施行自行檢查，並設置稽核單位，每年基於風險評估結果制</p>	符合公司治理實務守則規定。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			定稽核計畫，依據稽核計畫針對公司內部控制制度及相關法令遵循進行查核，並不定期進行專案查核及出具報告。 (七)客戶政策之執行情形 本公司已針對業務行銷策略、徵信、收款及客訴事件，設有專人處理，保持與客戶暢通之聯繫管道，並嚴守與客戶簽訂之相關合約已確保客戶之權益，維護良好關係，提供最佳服務。 (八)公司為董事購買責任險之情形 本公司每年定期評估投保額度，並於續保後向董事會報保情形。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 已改善項目：(一)自行編製 ESG 永續經營報告。(二)董事全面完成持續進修。(三)落實 ESG 永續經營政策。 未改善項目：(一)增加董事出席股東會出席率。(二)股東常會議事錄記載股東提問及公司回覆之重要內容。				

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

註2：所稱公司治理自評報告，係指依據公司治理自評項目，由公司自行評估並說明，各自評項目中目前公司運作及執行情形之報告。

(四) 公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1. 薪酬委員會成員資料

身分別 (註1)	姓名	條件	專業資格與經驗(註2)	獨立性情形(註3)	兼任其他公開發行 公司薪資報酬委員 會成員家數
獨立董事(召集人)	呂植富		請參閱第 14 頁，董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容。		0
獨立董事	高坤勇				0
獨立董事	彭慎翔 (註5)				0

註1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱第 14 頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

註2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5-8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

2. 薪資報酬委員會職責

薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- (1) 定期或不定期檢討本規程並提出修正建議。
- (2) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (3) 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司薪資報酬委員會計 3 人。

(2) 本屆委員任期：2023 年 6 月 21 日至 2025 年 6 月 20 日，2024 年度薪酬委員會開會 3 次，及 2025 年截至年報刊印止為 1 次，薪資報酬委員共召開 4 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) 【(B)/(A)】(註)	備註
召集人	呂植富	5	—	100	2023年6月21日連任
委員	高坤勇	5	—	100	2023年6月21日連任
委員	彭慎翔	3	—	100	2023年6月21日新任

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。
- 三、本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

薪資報酬委員會 日期/期別	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員 會意見之處理

2024.03.06 第五屆第二次	1.本公司 2023 年度董事酬勞及員工酬勞總數案。 2.本公司 2023 年度董事酬勞分配案。 3.本公司 2023 年經理人發放績效獎金討論案。	全體出席委員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
2024.05.08 第五屆第三次	1.本公司 2023 年度員工酬勞分配案。 2.本公司 2024 年經理人發放績效獎金討論案。	全體出席委員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
2024.11.06 第五屆第四次	1.本公司董事車馬費調整討論案。 2.本公司 2024 年經理人發放績效獎金討論案。 3.本公司 2024 年度經理人年終獎金討論案。 4.本公司 2025 年度經理人薪酬調整案。	全體出席委員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
2025.03.06 第五屆第五次	1.本公司 2024 年度董事酬勞及員工酬勞案。 2.本公司 2024 年經理人發放績效獎金討論案。	全體出席委員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

註：(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(五) 推動永續發展執行情形：

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		本公司推動永續發展兼職單位為財務部，並且會同公司其他相關權責部門共同致力各項企業社會責任、環境保護、公司治理...等議題之推行，並向董事會授權之總經理報告。本公司已於2024年8月7日董事會通過2023年度 ESG 永續報告書案並於公開資訊觀測站及本公司網站上發佈，且已於2023年2月成立溫室氣體盤查小組，並皆每季至董事會做報告。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定，無顯著差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		本公司已將營運相關之環境、社會及公司議題之風險融合於營運策略中，對於永續經營已考量公司現狀與法令規定，以循序漸進方式予以落實。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定，無顯著差異。
三、環境議題				
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		(一)本公司屬機械設備製造業，主要係進行設計研發，並進行各零件與模組...等之組裝作業，故對環境並不會產生污染。本公司已依法令規定每半年進行環境監測，並將監測結果公佈於公司網站及公佈欄週知，如有任何環境危害發生，將依監測顧問公司進行改善作業。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定，無顯著差異。
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		(二)本公司致力於源頭改善，提升各項資源之利用效率，來達成原物料減量目標，並強化垃圾分類，以確保資源可再回收利用；並且在所有廠房屋頂加裝太陽能板，以使用綠能降低對環境的衝擊。	
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	✓		(三)本公司參考「氣候相關財務揭露」(TCFD) 架構，揭露未來可能面臨之風險及其因應策略於永續報告書中。	
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		(四)本公司屬於自動化製造業，主要以研發及設備組裝為主，廢棄物主要為同仁日常生活之廢棄物，年度廢棄物約12公噸，依規定無須填寫廢棄物清理計畫書；且用水也僅有一般民生	

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
			<p>用水，年度平均用水量約為18.183千噸，故皆未列為本公司重大性議題，處理方式按照各地政府規定處理。因此，本公司僅透過溫室氣體盤查揭露本公司排放情形。</p> <p>本公司已統計過去兩年溫室氣體排放量並且已公告在本公司之網站上，本公司屬第3階段適用溫室氣體盤查體盤查及查證揭露時程，已提早規劃於2025年完成揭露母公司個體盤查資訊及確信情形。</p> <p>本公司已實施對環境的變化調節溫控措施，冬天冷氣提高2度，並提早2小時關閉空調，以達減碳目的，努力推動E化作業，且將回收紙再利用，以降低用紙量，並確實實施垃圾分類制度，以降低對環境負荷的衝擊。</p>	
四、社會議題				
(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序?	✓		<p>(一) 本公司於制訂管理制度及程序時嚴守各項勞動法規規定，以保障員工之合法權益。</p> <p>本公司長期關注員工職場友善環境，在女性員工任用上，截至2024年女性員工占員工總人數達 22.82%，而女性擔任管理階層的比例也佔 14.6%。在政策上，本公司制訂「工作規則」、「性騷擾防治」、「招募任用管理」等內部辦法，針對工時、假勤、性別等明確宣示保護員工權利，確保同仁獲得妥善照顧；針對懷孕員工，除定期追蹤、健康諮詢，也提供孕婦專屬停車位，給予懷孕員工充分照顧；針對有哺乳需求之員工，亦設有哺乳室。本公司致力於創造兩性友善工作環境，以多元化和包容性的工作場所，讓女性在職場也能充分發為所長。本公司配合《性別平等工作法》修法也於2024/10/8修訂《性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法》，以維護性別平等及提供員工、求職者與服務對象免受性騷擾之環境。2024年度已進行防治職場性騷擾宣導，共計數約298</p>	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定，無顯著差異。

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
			人次。	
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	✓		(二)本公司已制訂工作規則、員工待遇與出勤辦法等規章,並且制定績效獎金制度、員工分紅辦法、庫藏股轉讓辦法、員工認股權辦法...等將經營績效反映在員工之薪酬、獎金及股票,並且除辦理勞工之勞、健保,提撥勞工退休金外,並為全體員工投保團體意外險。本公司亦設有職工福利委員會,辦理各項福利事宜,包含員工旅遊、生日與婚喪喜慶禮金、公司社團設立與經費補助等。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定,無顯著差異。
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育?	✓		(三)本公司新進同仁於報到當天進行公司內部作業危害告知及有關規定,本公司亦針對服務年資優於勞動法規定定期實施健康檢查及安排安全教育訓練課程,並確實執行相關規定及消防安檢以維員工安全並提供健康之工作環境。本公司除了將安全之議題加入原先的5S中合併成6S,定期教育、檢示、稽核外,並已設置廠護一名,定期提供員工相關健康與安全資訊,亦不定期實施健康相關之問券調查並安排醫療專業人員提供諮詢服務。 本公司2024年已舉辦相關勞安與職場安全講習共20場,參與人數約122人次,其中包含每年至少兩次之消防演練。;健康教育講座共47場,參與人數約369人次、健康教育資訊宣導總共13,173人次。 本公司通過安心作業場所之認證、取得國建署之健康啟動認證與企業運動認證...等,並且獲得康健雜誌「CHR 健康企業公民」許諾企業。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定,無顯著差異。
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	✓		(四)本公司依據員工特質與業務性質,擬定其未來發展計畫,並定期與不定期舉辦相關之教育訓練課程。	
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷	✓		(五)本公司秉持誠信正直的理念來對待客戶,以客戶為導向,提	

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序?			供客戶所需的技術、嚴謹的生產、優良的品質和優質的服務。本公司網站上設有電子郵件信箱，處理有關公司客戶權益申訴之相關問題，提供公平、即時處理客戶之申訴管道。	
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形?	✓		(六)不定期督導本公司加工廠商，視其作業環境管理是否合乎法規，並挑選優質供應商作為長期合作夥伴，以共同提升企業對環境與社會所應盡之責任。本公司目前並無與供應商簽訂供貨契約之情事，惟與供應商接洽時，皆會提醒其留意避免對環境造成傷害，並於訪廠時留心供應商的環境、人員，以確保其在相關規範之履行。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定，無顯著差異。未來將視實際需求與法令需要，與供應商洽商企業責任之相關內容。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		本公司自2023年起，每年依循 GRI 準則編撰永續報告書，並參酌永續會計準則委員會(Sustainability Accounting Standards Board, SASB) 準則、氣候相關財務揭露(TCFD)等標準揭露報告資訊，讓利害關係人藉由報告書了解本公司於經濟、環境、社會面的運作情形，報告書已依規定申報於公開資訊觀測站，並揭露於公司網站。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定，無顯著差異。未來將視實際需求與法令需要編制永續報告書。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定「永續發展守則」，而公司在實際運作時，亦切實依循守則之內容。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司不定期捐款或捐贈物品與相關社福機構，藉此幫助及扶持社會弱勢團體；本公司愛心社更發起至育幼院參訪，提供院童娛樂活動與贈送相關禮品。本公司每年定期響應櫃買中心舉行之食物銀行捐助活動，且捐助與組隊參加知名企業舉辦的公益路跑活動；資助鄰近鄉鎮之活動，與社區積極互動，善盡社會公民職責；贊助學校舉辦音樂會及發表會...等活動。 本公司不定期參加各大專院校的企業徵才活動，並提供大專院校實習之機會、以及邀請來本公司進行參訪活動...等，同時並與社區大學合作，創建綠化共榮的社區氛圍。				

註1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

(六)上市上櫃公司氣候相關資訊：

1.氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形												
一、敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	為有效因應氣候變遷相關議題，本公司永續資訊管理專職單位掌握利害關係人對於氣候議題之相關要求與趨勢變化，召集相關權責部門進行氣候風險的評估與管理，並透過策略與目標擬訂，於每季一次向董事會報告及確認採取之行動。												
二、敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	本公司依據氣候變遷風險與機會評估方法，評估風險項目對本公司的衝擊以及發生時點。 氣候風險和機會辨識結果說明如下：												
三、敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	<table border="1" data-bbox="698 475 2072 1406"> <tr> <td data-bbox="698 475 875 671">風險類別</td> <td data-bbox="875 475 2072 671"> <ol style="list-style-type: none"> 1. 強降雨/強烈颱風侵台機會增加，造成廠房損壞風險(如樓頂廢氣塔損壞、漏水) 影響公司運作。 2. 缺水頻率增加，造成廠區供水不穩定，影響部分產線。 3. 氣候暖化，造成用電量增加，導致供電吃緊。 4. 氣候影響員工工作效率(出勤)或健康(如高溫環境將增加工安風險及強颱或極端降雨造成停班頻率高...等)。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="698 671 875 826">機會類別</td> <td data-bbox="875 671 2072 826"> <ol style="list-style-type: none"> 1. 執行再生能源市場評估及低碳燃料。 2. 規劃缺水及缺電的備用計畫。 3. 擬定節水/節電措施、減碳策略，透過 ISO 系統推動改善專案。 4. 配合客戶評估加入 SBTi 等國際倡議，設定減量目標。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="698 826 875 943">策略</td> <td data-bbox="875 826 2072 943"> <ol style="list-style-type: none"> 1. 節約能源、降低水電成本。 2. 提升防禦災害能力，降低營運中斷危機。 3. 節約用電降低成本。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="698 943 875 1257">風險管理</td> <td data-bbox="875 943 2072 1257"> <ol style="list-style-type: none"> 1. 為善盡保護環境的社會責任，於生產設備時一律禁用法令規範之有害物質，並將相關訊息傳遞至各部門，以確保本公司產品能符合客戶要求。 2. 本公司持續透過投注研發資源修改製程，改善設備生產效率及調整內部流程，藉此減少生產過程中之能源耗用量，以及因內部溝通流程間的謬誤所導致的後續資源浪費，以降低潛在的環保風險。 3. 溫室氣體的減量與管制，從產品設計、供應商管理、機台組裝到顧客服務階段，不斷努力控制溫室氣體排放。 4. 本公司屬於設備設計組裝公司，故溫室氣體皆以電力排放為主，並無高度污染物，且於廠內廣植樹木，以期達到碳中和的概念，並依此理念進行機器的研發與組裝。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="698 1257 875 1326">指標和目標</td> <td data-bbox="875 1257 2072 1326">依金融監督管理委員會 2022 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」訂定之溫室氣體盤查及查證時程規劃，目標每年執行減碳 1%。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="698 1326 875 1406">財務影響</td> <td data-bbox="875 1326 2072 1406"> <ol style="list-style-type: none"> 1. 影響組裝進度、營運成本增加。 2. 營運受影響致營收與獲利下降。 </td> </tr> </table>	風險類別	<ol style="list-style-type: none"> 1. 強降雨/強烈颱風侵台機會增加，造成廠房損壞風險(如樓頂廢氣塔損壞、漏水) 影響公司運作。 2. 缺水頻率增加，造成廠區供水不穩定，影響部分產線。 3. 氣候暖化，造成用電量增加，導致供電吃緊。 4. 氣候影響員工工作效率(出勤)或健康(如高溫環境將增加工安風險及強颱或極端降雨造成停班頻率高...等)。 	機會類別	<ol style="list-style-type: none"> 1. 執行再生能源市場評估及低碳燃料。 2. 規劃缺水及缺電的備用計畫。 3. 擬定節水/節電措施、減碳策略，透過 ISO 系統推動改善專案。 4. 配合客戶評估加入 SBTi 等國際倡議，設定減量目標。 	策略	<ol style="list-style-type: none"> 1. 節約能源、降低水電成本。 2. 提升防禦災害能力，降低營運中斷危機。 3. 節約用電降低成本。 	風險管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為善盡保護環境的社會責任，於生產設備時一律禁用法令規範之有害物質，並將相關訊息傳遞至各部門，以確保本公司產品能符合客戶要求。 2. 本公司持續透過投注研發資源修改製程，改善設備生產效率及調整內部流程，藉此減少生產過程中之能源耗用量，以及因內部溝通流程間的謬誤所導致的後續資源浪費，以降低潛在的環保風險。 3. 溫室氣體的減量與管制，從產品設計、供應商管理、機台組裝到顧客服務階段，不斷努力控制溫室氣體排放。 4. 本公司屬於設備設計組裝公司，故溫室氣體皆以電力排放為主，並無高度污染物，且於廠內廣植樹木，以期達到碳中和的概念，並依此理念進行機器的研發與組裝。 	指標和目標	依金融監督管理委員會 2022 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」訂定之溫室氣體盤查及查證時程規劃，目標每年執行減碳 1%。	財務影響	<ol style="list-style-type: none"> 1. 影響組裝進度、營運成本增加。 2. 營運受影響致營收與獲利下降。
風險類別	<ol style="list-style-type: none"> 1. 強降雨/強烈颱風侵台機會增加，造成廠房損壞風險(如樓頂廢氣塔損壞、漏水) 影響公司運作。 2. 缺水頻率增加，造成廠區供水不穩定，影響部分產線。 3. 氣候暖化，造成用電量增加，導致供電吃緊。 4. 氣候影響員工工作效率(出勤)或健康(如高溫環境將增加工安風險及強颱或極端降雨造成停班頻率高...等)。 												
機會類別	<ol style="list-style-type: none"> 1. 執行再生能源市場評估及低碳燃料。 2. 規劃缺水及缺電的備用計畫。 3. 擬定節水/節電措施、減碳策略，透過 ISO 系統推動改善專案。 4. 配合客戶評估加入 SBTi 等國際倡議，設定減量目標。 												
策略	<ol style="list-style-type: none"> 1. 節約能源、降低水電成本。 2. 提升防禦災害能力，降低營運中斷危機。 3. 節約用電降低成本。 												
風險管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為善盡保護環境的社會責任，於生產設備時一律禁用法令規範之有害物質，並將相關訊息傳遞至各部門，以確保本公司產品能符合客戶要求。 2. 本公司持續透過投注研發資源修改製程，改善設備生產效率及調整內部流程，藉此減少生產過程中之能源耗用量，以及因內部溝通流程間的謬誤所導致的後續資源浪費，以降低潛在的環保風險。 3. 溫室氣體的減量與管制，從產品設計、供應商管理、機台組裝到顧客服務階段，不斷努力控制溫室氣體排放。 4. 本公司屬於設備設計組裝公司，故溫室氣體皆以電力排放為主，並無高度污染物，且於廠內廣植樹木，以期達到碳中和的概念，並依此理念進行機器的研發與組裝。 												
指標和目標	依金融監督管理委員會 2022 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」訂定之溫室氣體盤查及查證時程規劃，目標每年執行減碳 1%。												
財務影響	<ol style="list-style-type: none"> 1. 影響組裝進度、營運成本增加。 2. 營運受影響致營收與獲利下降。 												

	3. 用電量增加，成本與排碳量上升。
四、敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	近年來全球暖化導致氣候變遷加劇，且環保節能、綠色經濟及環境保育等意識高漲，各國企業相繼祭出應對方案，而鈦昇為因應氣候變遷後所帶來之衝擊，針對各風險擬定相對應之策略，期望減少能源消耗並降低碳排放，提升減碳管理績效，以落實企業永續發展之目標。本公司參考「氣候相關財務揭露」(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 架構，揭露未來可能面臨之風險及其因應策略。
五、若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	本公司目前仍未對氣候變遷風險所帶來之財務影響有量化評估結果。
六、若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	本公司目前仍未對氣候變遷風險所帶來之財務影響有量化評估結果，故仍未有具體轉型指標。
七、若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	公司尚未使用內部碳定價。
八、若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	請參閱本年報【(3)溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫】。
九、溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於I-1及I-2)。	請參閱本年報【(1)最近二年度公司溫室氣體盤查資訊】、【(2)溫室氣體確信資訊】及【(3)溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫】。

2.最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

(1)溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。		
項目	2023 年	2024 年
範疇一：直接溫室氣體排放(公噸 CO ₂ e)	110.0642	117.4665

範疇二：間接溫室氣體排放(公噸 CO2e)	2,526.7835	2,602.1121
總排放量=範疇一+範疇二(公噸 CO2e)	2,636.8477	2,719.5786
溫室氣體排放強度(公噸 CO2e/全職員工數)	8.40	9.13
<p>註： 1. 範疇一是針對直接來自於本公司所擁有或控制的排放源，其包含固定燃燒源、製程排放、交通運輸之移動 燃燒源及逸散性的排放源，排放係數依經濟部能源局最新公告數據 6.0.4 版(IPCC 第六次評估報告)計算。</p> <p>2. 範疇二是指能源間排放，如外購電力。電力排放係數依經濟部能源局最新公告之最新電力排碳係數計算。</p> <p>3. 溫室氣體排放種類：二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)。</p> <p>4. 外購電力引用經濟部能源局公告之電力排放係數，2023 年電力排 放係數=0.494kgCO2e ；2024 年電力排放係數=0.474kgCO2e。</p>		

註 1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間排放量(範疇二，即來自於輸入 電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能 源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

註 2：直接排放量及能源間排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，其他間接 排放量資訊得自願揭露。

註 3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書 (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol) 或國際標準組織 (International Organization for Standard-ization, ISO) 發布之 ISO 14064-1。

註 4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額 (新臺幣百萬元) 計算 之數據。

(2)溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

本公司近幾年之溫室氣體盤查報告目前皆只有內部查證動作，無做外部保證/確信，已預於2025年委託外部驗證機構對本公司溫室氣體排放量進行驗證確信。

註1：應依本準則第10條第2項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書 揭露」，若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。

註2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。

(3)溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

◆溫室氣體減量基準年及減量目標

本公司早於2015年就進行溫室氣體盤查，在2023年才正式成立溫室氣體盤查小組，我們將訂2023年作為減碳基準年，目標依照金管會之「上市櫃公司永續發展路徑圖」預計每年執行減碳1%。

◆溫室氣體減量策略及具體行動計畫

1. 2023年參與日月光公司以大帶小專案計畫，攜手供應鏈碳管理，共同響應溫室氣體排放減量目標，以因應氣候變遷挑戰。
2. 將耗電量較大的設備汰舊換新為節能設備。
3. 樓梯、茶水間等照明安裝感應器，以達節能減碳作為。

◆減量目標達成情形

因目前仍未完成外部盤查及查證作業，已預於 2025 年委託外部驗證機構對本公司溫室氣體排放量進行驗證確信，將於完成盤查後依據減量策略公開揭露。

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理。

註 2：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，例如依本準則第 10 條第 2 項規定之令，資本額 100 億元以上之公司應於 114 年完成 113 年度合併財務報告之盤查，故基準年為 113 年，倘公司已提前完成合併財務報告之盤查，得以該較早年度為基準年，另基準年之數據得以單一年度或數年度平均值計算之。

(七)公司履行誠信經營情形及採行措施：

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾?	✓		(一)本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，對於誠信經營政策，及董事會與管理階層承諾積極落實之情形，已考量公司現狀與法令規定，以循序漸進方式落實。	符合上市上櫃公司誠信經營守則。
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施?	✓		(二)誠信與可靠係本公司企業文化中最重要之核心價值，於新進員工之教育訓練及在職訓練中宣傳，並且於工作規則與防範內線交易管理作業程序中皆有相關規範，並建立完善的違規懲戒及申訴制度，以防範不誠信行為之發生。	
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案?	✓		(三)本公司「工作規則」及「誠信經營作業程序及行為指南」皆規定不得要求、接受或給予任何可能損及忠於職守或專業判斷之餽贈、招待或任何形式的賄絡。並已要求集團內所有員工皆於入職時即簽署「營業保密、智慧財產及誠信道德規範協定」以落實誠信的行為指南，該協議皆定期檢討內容是否充分與適切。本公司亦設有檢舉與申訴電子信箱(goodfaith@enr.com.tw)，如有接獲違反誠信行為之情事，均會指派資深高階主管與稽核單位聯合妥善處理。	
二、落實誠信經營				
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來	✓		(一)本公司與他人簽訂契約時，均盡可能充分了解對方誠信經營	符合上市上櫃公司誠信經營

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款?			情形，並將誠信經營納入商業契約中。	守則，無顯著差異。未來將視實際需求與相關法令以循序漸進方式落實。
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形?		✓	(二)本公司雖尚未設置企業誠信經營專職單位，但已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，由營運總管理處及人資部共同執行，皆依「上市上櫃公司企業誠信經營守則」為原則，以循序漸進方式落實，且藉由內部稽核之查核作業，應可了解公司各層面是否符合誠信之要求。此外，公司管理階層亦嚴格遵守誠信經營規定，並至少一年一次向董事會報告，以在公司內部樹立良好行為之標竿。	
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行?	✓		(三)本公司已於「誠信經營作業程序及行為指南」中明定應迴避任何可能造成個人利益與公司利益之間的衝突。董事對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，皆予以迴避，不參與討論及表決。	
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核?	✓		(四)本公司設有嚴謹之會計制度及專責之會計單位，財務報告均經簽證會計師查核，確保財務報表之公允性；內部稽核人員亦依照稽核計畫執行查核，以確保公司內部控制制度之有效運作。	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練?	✓		(五)本公司定期或不定期推動誠信經營相關之教育訓練課程及宣導事項。	
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員?	✓		本公司設有檢舉與申訴電子信箱(goodfaith@enr.com.tw)，如有接獲違反誠信行為之情事，均會指派資深高階主管與稽核單位聯合妥善處理，視情節狀況報請總經理做適當之懲處，現行運作以營運總管理處、人資部與稽核室為檢舉管道，如有違反誠信行為將依員工懲戒辦法辦理。	符合上市上櫃公司誠信經營守則。
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制?	✓		本公司已明訂保護檢舉人，使其不因檢舉事項而遭受不當之處置。	
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置	✓			

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
之措施?				
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效?	✓		本公司已架設網站揭露本公司所訂定之「誠信經營作業程序及行為指南」，並於年報中揭露誠信經營推動落實之情形。	符合上市上櫃公司誠信經營守則。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司依照誠信經營作業程序及行為指南之精神執行，以循序漸進方式落實，其運作與守則中所規範內容並無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司隨時留意誠信經營相關規範之發展，據以檢討本公司之誠信經營政策，以確實落實誠信經營之政策。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

- 1.本公司訂有經董事會授權之「逐級授權辦法」，以落實分層負責管理機制，本公司的內部控制制度係依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」制定，並由內部稽核單位每年依據風險評估之稽核計畫查核，並向審計委員及董事會報告查核結果。
- 2.本公司投保相關保險以規避風險，並且已為董事購買責任保險。
- 3.本公司依據「證券交易法第一百五十七條之一第五項及第六項重大消息範圍及其公開方式管理辦法」規定辦理，不定期且即時於公開資訊觀測站揭露有關本公司之重大訊息；並且本公司訂有「防範內線交易管理作業程序」避免資訊不當洩漏並防範內線交易情形發生，以保障本公司與所有利害關係人之權益。

(八)內部控制制度執行狀況

- 1.內部控制聲明書：請詳公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>)，輸入公司代號及年度。
- 2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

會別	日期	重要決議事項
董事會	2024.03.06	1.本公司 2023 年度董事酬勞及員工酬勞總數案。 2.本公司 2023 年度董事酬勞分配案。 3.本公司 2023 年經理人發放績效獎金討論案。 4.本公司 2023 年度營業報告書及財務報表案。 5.本公司 2023 年度盈餘分配表案。 6.本公司擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.本公司擬對轉投資公司「江蘇鈦昇科技有限公司」新增資金貸與案。 8.本公司轉投資公司「江蘇鈦昇科技有限公司」擬對轉投資公司「辰鈦(上海)貿易有限公司」新增資金貸與案。 9.本公司擬對轉投資公司「無錫鈦升半導體材料科技有限公司」新增資金貸與案。 10.公司基於經營業務之避險需要，擬預購或預售、換匯換利及匯率交換所需之外幣案。 11.本公司擬通過「金太越科技股份有限公司」投資案。 12.本公司「內部控制制度聲明書」承認案。 13.本公司 2024 年度營運計畫案。 14.本公司擬召開 2024 年股東常會相關事宜案。 15.本公司受理 2024 年股東提案相關事宜。

會別	日期	重要決議事項
董事會	2024.05.08	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司 2023 年度員工酬勞分配案。 2.本公司 2024 年經理人發放績效獎金討論案。 3.本公司 2024 年第 1 季合併財務報表案。 4.本公司配合國富浩華聯合會計師事務所內部調整更換會計師案。 5.本公司擬對轉投資公司「江蘇鈦昇科技有限公司」新增資金貸與案。 6.本公司擬對轉投資公司「無錫鈦升半導體材料科技有限公司」新增資金貸與案。 7.本公司擬通過「欣鉅興科技股份有限公司」投資案。 8.本公司擬訂定 2024 年第 1 季第三次無擔保轉換公司債換發普通股增資基準日案。
股東會	2024.06.20	<p>*報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 第一案：本公司 2023 年度營業報告。 第二案：本公司 2023 年度審計委員會審查報告。 第三案：本公司國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。 第四案：本公司 2023 年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。 第五案：本公司 2023 年度盈餘分配現金股利情形報告。 <p>*承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 第一案：本公司 2023 年度營業報告書及財務報表案。 第二案：本公司 2023 年度盈餘分派表案。 <p>*討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 第一案：本公司擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 <p>*股東提問：無此情形。</p> <p>*股東會執行情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司 2023 年度營業報告書及財務報表承認案已承認。 2.本公司 2023 年度盈餘分派表承認案已承認，並已於 2024.04.29 發放現金股利每股 0.50085125 元。 3.本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案已通過。
董事會	2024.08.07	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司擬通過 2024 年第 2 季合併財務報表案。 2.本公司擬通過轉投資公司 Enrichment Tech. Corporation 減資彌補虧損案。(USD100 萬) 3.本公司擬對孫公司「無錫鈦升半導體材料科技有限公司」新增資金貸與案。 4.本公司擬透過新加坡控股公司設立馬來西亞轉投資公司案。 5.本公司擬通過「會計制度」修訂案。 6.本公司擬通過 2023 年度 ESG 永續報告書案。 7.本公司擬通過電子載帶事業處轉投資公司總經理任命追認案。 8.本公司擬通過營運長及策略暨投資長任命案。
董事會	2024.11.06	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司 2024 年經理人發放績效獎金討論案。(2024Q2~3) 2.本公司 2024 年度經理人年終獎金討論案。 3.本公司 2025 年度經理人薪酬調整案。 4.本公司 2024 年第 3 季合併財務報表案。 5.本公司擬提供轉投資公司「唐威科技股份有限公司」背書保證追認案。 6.本公司擬對孫公司「無錫鈦升半導體材料科技有限公司」新增資金貸與案。 7.本公司之轉投投資公司「江蘇鈦昇科技有限公司」變更公司名稱追認案。 8.本公司擬對轉投資公司「江蘇鈦晟半導體科技有限公司」新增資金貸與案。 9.本公司擬通過「內部控制制度」修訂案。

會別	日期	重要決議事項
		10.本公司擬通過 2025 年度稽核計畫案。 11.本公司擬修訂「董事會議事規範」討論案。 12.本公司擬訂定「公司治理實務守則」討論案。 13.本公司擬訂定「永續發展實務守則」並廢止「企業責任實務守則」討論案。 14.本公司擬設定投資限額案。 15.本公司擬通過 2025 年度往來銀行借款額度案。 16.本公司擬訂定 2024 年第 3 季行使 2021 年度發行之員工認股權憑證暨第三次無擔保轉換公司債換發普通股增資基準日案。 17.本公司擬通過執行長任命案。 18.本公司董事車馬費調整討論案。
董事會	2024.12.25	1.本公司擬對轉投資公司「江蘇鈦晟半導體科技有限公司」新增資金貸與案。 2.本公司 2025 年度營運計畫案。
董事會	2025.03.06	1.本公司 2024 年度董事酬勞及員工酬勞案。 2.本公司 2024 年經理人發放績效獎金討論案。 3.本公司擬修訂「公司章程」部分條文討論案。 4.本公司 2024 年度營業報告書及財務報表案。 5.本公司 2024 年度盈虧撥補表案。 6.本公司擬對轉投資公司「江蘇鈦晟半導體科技有限公司」新增資金貸與案。 7.本公司擬對轉投資公司「無錫鈦升半導體材料科技有限公司」及「江蘇鈦晟半導體科技有限公司」新增資金貸與案。 8.本公司擬通過「欣鉅興科技股份有限公司」增資案。 9.本公司擬通過銀行聯合授信合約案。 10.本公司「內部控制制度聲明書」承認案。 11.本公司擬通過「內部控制制度」修訂案。 12.本公司擬召開 2025 年股東常會相關事宜案。 13.本公司受理 2025 年股東提案相關事宜。 14.本公司擬訂定 2024 年第 4 季行使 2021 年度發行之員工認股權憑證暨第三次無擔保轉換公司債換發普通股增資基準日案。
董事會	2025.04.09	1.本公司擬實施第 12 次買回庫藏股討論案。
董事會	2025.04.25	1.本公司擬通過 2025 年第 1 季合併財務報表案。 2.本公司擬對轉投資公司「江蘇鈦晟半導體科技有限公司」新增資金貸與案。 3.本公司擬對轉投資公司「無錫鈦升半導體材料科技有限公司」新增資金貸與案。 4.本公司擬通過「雷大光電股份有限公司」增資案。 5.本公司擬通過銀行聯合授信案。 6.本公司擬取消原代江蘇鈦晟半導體科技有限公司出售部分廠房案。 7.本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。 8.本公司擬訂定 2025 年第 1 季第三次無擔保轉換公司債換發普通股增資基準日案。 9.本公司擬更新召開 2025 年股東常會相關事宜案。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容：無此情事。

四、簽證會計師公費資訊：

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
國富浩華聯合會計師事務所	謝仁耀	2024.01~2024.12	2,390	1. 工商登記 47 2. 英文版財務報告 209 3. 存貨報廢簽證費用 20 4. 營所稅暫繳申報費用 65 5. 非擔任主管職稱之員工薪資資訊檢查表 25	2,756	無
	李國銘	2024.01~2024.12				

(一) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

(二) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

五、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師：

更換日期	2024年05月08日經董事會通過		
更換原因及說明	配合相關法令及國富浩華會計師事務所內部職務調動之需求，自2024年第2季起更換簽證會計師由就舊任李青霖會計師及李國銘會計師改為謝仁耀會計師及李國銘會計師。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	情況	當事人	會計師
		主動終止委任	不適用
		不再接受(繼續)委任	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有	會計原則或實務	
		財務報告之揭露	
		查核範圍或步驟	
		其他	
	無	V	
說明			
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二) 關於繼任會計師：

事務所名稱	國富浩華會計師事務所
會計師姓名	李青霖會計師及李國銘會計師
委任之日期	2024年05月08日經董事會通過
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三) 前任會計師對本準則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：不適用。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，上應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、監察人、持股比例超過百分之十股東之關係或質押股數：

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

股權移轉：請詳公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1)，輸入公司代號及年度。

股權質押變動情形：請詳公開資訊觀測(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1)，輸入公司代號及年度。

(二) 股權移轉之相對人為關係人者，應揭露之：

姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
陳坤山	贈與	2023.02 2023.02	許妙 陳郁閔	配偶 子女	200,000 45,000	不適用
張光明	贈與	2023.02	張景筌	子女	35,000	不適用
朱育民	贈與	2023.12	朱峻逸	子女	30,000	不適用
林傑倫	贈與	2023.05	林羿丞	子女	50,000	不適用
曹瑞龍	贈與	2024.03	曹根瀚	子女	11,000	不適用

(三) 股權質押之相對人為關係人者，應揭露之：無此情形。

八、持股比例佔前十名之股東，其相互間之關係之資訊：

2025年04月14日；單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
王明慶	4,200,334	3.97%	0	0%	822,956	0.8%	-	-	-
趙蓬軒	3,550,000	3.36%	0	0%	0	0%	-	-	-
毛重富	2,119,000	2.01%	0	0%	0	0%	-	-	-
公小穎	1,754,000	1.66%	0	0%	0	0%	-	-	-
蔣秀華	1,580,000	1.50%	0	0%	0	0%	-	-	-
黃將庭	1,215,680	1.15%	0	0%	0	0%	-	-	-
張光明	1,059,661	1.00%	0	0%	0	0%	-	-	-
楊裕國	1,004,000	0.95%	0	0%	0	0%	-	-	-
陳坤山	949,428	0.90%	0	0%	0	0%	-	-	-
蔡燈順	911,000	0.86%	0	0%	0	0%	-	-	-

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

2025年03月31日；單位：仟股；%

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
香港鈦昇半導體材料有限公司	15,000	100.00%	—	—	15,000	100.00%
ENRICHMENT TECH.CORPORATION	7,290	100%	—	—	7,290	100%
唐威科技(股)公司	2,500	51.43%	—	—	2,500	51.43%
EXCELLENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	9,709	100%	—	—	9,709	100%
EXCELLENT TECHKNOWLEDGIES HOLDINGS PTE. LTD.	101	100%	—	—	101	100%

註：係本公司之長期股權投資。

叁、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源：

1.股本形成經過

單位：新臺幣仟元；仟股

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款	其他
2016.01	12.1	100,000	1,000,000	55,406	554,060	員工認股權新股5,295 註銷庫藏股與限制型新股10,325	—	2016.01.13 經授商字第10501004660號
2016.04	12.1	100,000	1,000,000	55,459	554,590	員工認股權新股575 註銷限制型新股45	—	2016.04.25 經授商字第10501075000號
2016.05	12.1	100,000	1,000,000	55,195	551,954	員工認股權新股61.5 註銷限制型新股325.1	—	2016.05.27 經授商字第10501107890號
2016.09	11.9	100,000	1,000,000	53,947	539,476	註銷庫藏股1,245 註銷限制型新股2.8	—	2016.09.07 經授商字第10501216420號
2016.11	11.9	100,000	1,000,000	54,184	541,841	員工認股權新股237	—	2016.11.25 經授商字第10501273150號
2017.04	11.9	100,000	1,000,000	54,005	540,050	員工認股權新股28 註銷限制型新股206	—	2017.04.06 經授商字第10601041500號
2017.06	11.9 19.19	100,000	1,000,000	61,643	616,436	員工認股權新股401 可轉換公司債7,238	—	2017.06.05 經授商字第10601070530號
2017.09	28 11.9 19.02~ 19.19	100,000	1,000,000	75,997	759,961	現金增資10,000 員工認股權新股116 可轉換公司債4,237	—	2017.09.01 經授商字第10601122400號
2017.12	11.9 19.02	100,000	1,000,000	76,872	768,723	員工認股權新股144 可轉換公司債731	—	2017.12.07 經授商字第10601164010號
2018.03	11.9 19.02	100,000	1,000,000	78,190	781,897	員工認股權新股156 可轉換公司債1,162	—	2018.03.27 經授商字第10701031760號
2018.04	11.9 19.02	100,000	1,000,000	78,585	785,852	員工認股權新股101 可轉換公司債294	—	2018.04.20 經授商字第10701038520號
2018.08	19.02	100,000	1,000,000	79,221	792,213	可轉換公司債636	—	2018.08.22 經授商字第10701108020號
2018.12	11.9 19.02	100,000	1,000,000	79,783	797,828	員工認股權新股20 可轉換公司債542	—	2018.12.11 經授商字第10701150420號
2019.04	19.02	100,000	1,000,000	79,794	797,943	註銷庫藏股814 可轉換公司債825	—	2019.04.23 經授商字第10801036620號
2019.05	11.9	100,000	1,000,000	79,884	798,843	員工認股權新股90	—	2019.05.16 經授商字第10801057730號
2019.11	10	120,000	1,200,000	81,462	814,618	盈餘轉增資1,578	—	2019.10.21 經授商字第10801142100號
2020.11	42.22	120,000	1,200,000	84,152	841,524	可轉換公司債2,690	—	2020.11.30 經授商字第10901222280號

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款	其他
2021.03	42.22	120,000	1,200,000	85,431	854,314	可轉換公司債1,279	—	2021.03.24 經授商字第11001046480號
2021.05	42.22	120,000	1,200,000	90,273	902,726	可轉換公司債48,412	—	2021.05.31 經授商字第11001087320號
2021.08	66	120,000	1,200,000	100,273	1,002,726	現金增資100,000	—	2021.08.05 經授商字第11001132410號
2021.11	15.7 42.14	120,000	1,200,000	100,048	1,000,476	員工認股權新股4,225 可轉換公司債1,825 註銷庫藏股8,300	—	2021.11.25 經授商字第11001217650號
2022.04	42.14	120,000	1,200,000	100,102	1,001,020	可轉換公司債546	—	2022.04.11 經授商字第11101056640號
2022.10	15.4 41.31	150,000	1,500,000	100,770	1,007,702	員工認股權新股5,350 可轉換公司債1,332	—	2022.10.31 經授商字第11101208210號
2023.03	15.4 41.31	150,000	1,500,000	99,595	995,953	員工認股權新股125 可轉換公司債3,026 註銷庫藏股14,900	—	2023.03.27 經授商字第11230049990號
2023.08	-	150,000	1,500,000	98,595	985,953	註銷庫藏股10,000	—	2023.08.28 經授商字第11230164030號
2024.05	65.08 64.74	150,000	1,500,000	102,735	1,027,355	可轉換公司債4,140	—	2024.06.13 經授商字第11330099540號
2024.12	29.9 64.74	150,000	1,500,000	106,427	1,064,275	員工認股權新股212 可轉換公司債3,480	—	2024.12.02 經授商字第11330205040號
2025.03	29.9 64.74	150,000	1,500,000	108,381	1,083,813	員工認股權新股151 可轉換公司債1,802	—	2025.03.24 經授商字第11330205040號
2025.05	64.74	150,000	1,500,000	108,496	1,084,956	可轉換公司債114	—	2025.04.25 董事會決議通過增資基準日辦理變更中

2. 股份種類

2025年04月14日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	108,381,345	41,618,655	150,000,000	屬上櫃股票

3.若經核准以總括申報制度募集發行有價證券者，另應揭露核准金額、預定發行及已發行有價證券之相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單

持股比例達 5% 以上之股東或持股比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

2025 年 04 月 14 日；單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
王明慶		4,200,334	3.97%
趙蓬軒		3,550,000	3.36%
毛重富		2,119,000	2.01%
公小穎		1,754,000	1.66%
蔣秀華		1,580,000	1.50%
黃將庭		1,215,680	1.15%
張光明		1,059,661	1.00%
楊裕國		1,004,000	0.95%
陳坤山		949,428	0.90%
蔡燈順		911,000	0.86%

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策：

本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：

- (1) 依法提繳稅款。
- (2) 彌補累積虧損。
- (3) 提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。
- (4) 依法令規定或營運必要提撥特別盈餘公積；扣除前各項餘額後，再加計上年度累積未分配盈餘後，由董事會擬具股東紅利分派案，提請股東會決議分派之。股東紅利之分派，得以股票股利或現金股利方式為之。

公司未來將配合所處環境及成長階段，基於資本資出、業務擴充需要、健全財務規劃及兼顧股東利益以求永續發展，本公司股利政策將依公司未來之資本支出預算及資金需求情形，就上述可供分配盈餘提撥不低於 10% 分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本 5% 時，得不予分配。分配股東紅利時，得以股票股利或現金股利方式為之，其中現金股利之分派比率以不得低於股東紅利總額之 10%。若公司有重大投資或發展政策時，得全數以股票股利發放之。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形：

本公司於 2025 年 03 月 06 日董事會決議通過不發放股東紅利。

3. 預期股利政策將有重大變動說明：無。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本年度未有無償配股之情事，故不適用。

(五) 員工、董事及監察人酬勞：

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

公司章程	內 容
第三十條	本公司年度如有獲利，應提撥 5~10%作為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 3%為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。
第三十條之一	本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之： 1. 依法提繳稅款。 2. 彌補累積虧損。 3. 提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。 4. 依法令規定或營運必要提撥特別盈餘公積；扣除前各項餘額後，再加計上年度累積未分配盈餘後，由董事會擬具股東紅利分派案，提請股東會決議分派之。 本公司未來將配合所處環境及成長階段，基於資本資出、業務擴充需要、健全財務規劃及兼顧股東利益以求永續發展，本公司股利政策將依公司未來之資本支出預算及資金需求情形，就上述可供分配盈餘提撥不低於 10% 分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本 5% 時，得不予分配。分配股東紅利時，得以股票股利或現金股利方式為之，其中現金股利之分派比率以不得低於股東紅利總額之 10%。若公司有重大投資或發展政策時，得全數以股票股利發放之。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

2. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

(1) 員工酬勞之估列基礎：

依據公司章程第三十條規定，公司年度如有獲利，應提撥 5~10%作為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞，員工酬勞分派案應提股東會報告。

(2) 董事、監察人酬勞之估列基礎：

依據公司章程第三十條規定，公司年度如有獲利，由董事會決議提撥不高於 3%為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥董事酬勞。

(3) 以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：若股東會決議採股票發行員工紅利，股票紅利股數按決議分紅之金額除以股票公平價值決定，股票公平價值係指股東會決議日前一日的收盤價（考量除權除息之影響後）。

(4) 實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

於股東會決議日時，若金額有變動，則依會計估計變動處理，列為次年度之損益。

3.董事會通過分派酬勞情形

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額；若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：無。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

4.前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：無分配情形，不適用。

(六)公司買回本公司股份情形：

1.公司買回本公司股份情形(已執行完畢者)

2025年04月30日

買回期次	2022年第8次	2022年第9次	2023年第10次	2023年第11次
買回目的	轉讓股份予員工	維護公司信用及股東權益	維護公司信用及股東權益	轉讓股份予員工
買回期間	2022年10月14日~11月11日	2022年11月14日~12月13日	2023年03月23日~05月08日	2023年06月07日~06月15日
買回區間價格	每股50元至80元	每股50元至80元	每股50元至70元	每股50元至70元
已買回股份種類及數量	989,000股	1,490,000股	1,000,000股	1,000,000股
已買回股份金額	51,705,794元	82,534,958元	50,564,662元	60,943,547元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	98.9%	99.3%	100%	100%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0股	1,490,000股	1,000,000股	0股
累積持有本公司股份數	1,823,000股	1,823,000股	1,823,000股	2,823,000股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	1.69%	1.69%	1.69%	2.61%

註1：2022年第8、11次買回本公司股票尚未進行讓轉。

註2：2022年第9次買回本公司股票於2023年03月07日經董事會決議通過註銷，並訂定減資基準日為2023年03月09日，業經經濟部2023年03月27日經授商字第11230049990號函核准減資註銷庫藏股。

註3：2023年第10次買回本公司股票於2023年08月10日經董事會決議通過註銷，並訂定減資基準日為2024年08月15日，業經經濟部2023年08月28日經授商字第11230164030號函核准減資註銷庫藏股。

2.公司買回本公司股份情形(尚在執行中者)

2025年04月30日

買回期次	2025年第12次
買回目的	維護公司信用及股東權益
買回期間	2025年04月10日~06月09日
買回區間價格	每股50元至80元
已買回股份種類及數量	641,000股
已買回股份金額	46,387,236元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	42.74%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0股
累積持有本公司股份數量	3,464,000股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	3.20%

二、公司債辦理情形

(一)尚未償還及辦理中之公司債

公司債種類	2022年度國內第三次無擔保轉換公司債
發行日期	2022年07月13日
面額	新臺幣壹拾萬元整
發行及交易地點	—
發行價格	依面額十足發行
總額	新臺幣1,000,000千元整
利率	0%
期限	5年期 到期日：2027.07.13
保證機構	不適用
受託人	永豐商業銀行股份有限公司信託部
承銷機構	台中銀證券股份有限公司
簽證律師	不適用
簽證會計師	不適用
償還方法	到期一次還本
未償還金額	截至2025年4月14日止，尚未贖回或轉換之公司債餘額為381,300仟元
贖回或提前清償之條款	1.本債券自2022年10月14日起(發行滿三個月翌日起)至2027年6月3日止(到期前四十日止)，若本公司普通股收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)者，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份一個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本債券之投資人，則以公告方式

公 司 債 種 類	2022 年度國內第三次無擔保轉換公司債
	<p>為之)，贖回價格訂為本債券面額，以現金收回其全部債券，且函請櫃檯買賣中心公告。本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金收回其流通在外之本債券。</p> <p>2.本債券自2022年10月14日起(發行滿三個月翌日起)至2027年6月3日止(到期前四十日止)，若本債券流通在外餘額低於原發行總面額之10%時，本公司得於其後任何時間，以掛號寄發一份一個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本債券之投資人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本債券面額，以現金收回其全部債券，且函請櫃檯買賣中心公告。本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金收回其流通在外之本債券。</p> <p>3.若債權人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未以書面回覆本公司股務代理機構(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳日為憑)者，本公司於債券收回基準日後五個營業日內，將其所持有之本債券依債券面額以現金收回。</p> <p>4.本公司執行本轉換公司債券收回請求時，債券持有人請求轉換之最後期限為終止櫃檯買賣日後第二個營業日。</p> <p>5.本債券以發行後屆滿三年及四年之日(2025年7月13日及2026年7月13日)為本債券持有人提前賣回本債券之賣回基準日。本公司應於賣回基準日之四十日前(2025年6月3日及2026年6月3日)，以掛號寄發一份「賣回權行使通知書」予債券持有人(以「賣回權行使通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本債券之債券持有人，則以公告方式為之)，並函請櫃檯買賣中心公告本債券持有人賣回權之行使，本債券持有人得於賣回基準日之前四十日內以書面通知本公司股務代理機構(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳為憑)，要求本公司以債券面額加計利息補償金【滿三年為債券面額之101.5075%(實質收益率為0.50%)；滿四年為債券面額之102.0151%(實質收益率為0.50%)】將其所持有之本債券以現金贖回。本公司受理賣回請求，應於賣回基準日後五個營業日內以現金贖回本債券。前述日期如遇證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。</p>
限 制 條 款	<p>(一)現金股利</p> <p>1.本債券持有人於當年度一月一日起至當年度本公司現金股息停止過戶日前十五個營業日(不含)以前請求轉換者，得參與當年度股東會決議發放之前一年度現金股利。</p> <p>2.當年度於本公司現金股息停止過戶日前十五個營業日(含)起至現金股息除息基準日(含)止，停止本債券轉換。</p> <p>3.本債券持有人於當年度現金股息除息基準日翌日起至當年度十二月三十一日(含)以前請求轉換者，不得享有當年度股東會決議發放之前一年度現金股利，但得參與次年度股東會決議發放之當年度現金股利。</p> <p>(二)股票股利</p> <p>1.本債券持有人於當年度一月一日起至當年度本公司無償配股停</p>

公司債種類		2022 年度國內第三次無擔保轉換公司債	
		止過戶日前十五個營業日(不含)以前請求轉換者,得參與當年度股東會決議發放之前一年度股票股利。 2.當年度於本公司無償配股停止過戶日前十五個營業日(含)起至無償配股除權基準日(含)止,停止本債券轉換。 3.本債券持有人於當年度無償配股除權基準日翌日起至當年度十二月三十一日(含)以前請求轉換者,不得享有當年度股東會決議發放之前一年度股票股利,但得參與次年度股東會決議發放之當年度股票股利。	
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		無	
附其他權利	已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無	
	發行及轉換(交換或認股)辦法	詳公司債發行及轉換辦法	
對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		若以目前轉換價格每股新臺幣 64.74 元計算,預計轉換 5,889,713 股,對目前已發行股數 108,381,345 股之最大稀釋程度為 5.44%。轉換公司債之股權稀釋視轉換情形而定,以漸進方式產生而具遞延效果,故整體而言,對股東權益稀釋影響尚屬有限。	
交換標的委託保管機構名稱		無	

(二)一年內到期之公司債：本公司 2022 年度發行之國內第三次無擔保轉換公司債係於 2027 年 7 月 13 日到期，故未有一年內到期之公司債。

(三)已發行附有得轉換為普通股、海外存託憑證或其他有價證券之轉換公司債者，應列示下表

2025 年 04 月 30 日單位：新臺幣元

公司債種類		2022 年度國內第三次無擔保轉換公司債		
年度		2023 年度	2024 年度	2025 年截至 4 月 30 日
項目				
轉換公司債市價	最高	127	219	150
	最低	101	118.35	122.7
	平均	110.79	150.40	136.67
轉換價格		67.6	64.74	64.74
發行日期及發行時轉換價格		發行日期:2022.07.13, 發行時轉換價格為 67.60 元, 於 2023 年 4 月 27 日調整轉換價格為 65.08 元, 於 2024 年 4 月 9 日調整轉換價格為 64.74 元		
履行轉換義務方式		發行新股		

(四)已發行交換公司債：無。

(五)採總括申報方式募集與發行普通公司債：無。

(六)已發行附認股權公司債：無。

(七)最近三年度私募公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形

(一)截至年報刊印日止，公司尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響：

2025年04月30日

員工認股權憑證種類	2021年第1次發行 員工認股權憑證
申報生效日期	2021年10月12日
發行日期	2021年11月15日
存續期間	5年
發行單位數	500單位
發行得認購股數占已發行 股份總數比率	0.46%
得認股期間	2023/11/15~2026/11/14
履約方式	發行新股
限制認股期間及比率(%)	屆滿2年累計得認股比例為50% 屆滿3年累計得認股比例為75% 屆滿4年累計得認股比例為100%
已執行取得股數	363,250股
已執行認股金額	10,861,175元
未執行認股數量	136,750股
未執行認股者其每股認購 價格	新臺幣29.9元
未執行認股數量占已發行 股份總數比率(%) (註)	0.13%
對股東權益影響	本認股權憑證存續期間為5年，於發行日屆滿兩年後始執行，對原有普通股股東權益逐年稀釋，故稀釋效果及對股東權益影響尚屬有限。

註：已發行股份總數係指經濟部變更登記資料所列股數。

(二)累積至年報刊印日止，取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：

單位：股；新臺幣：仟元 2025年04月30日

	職稱	姓名	發行日	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率(註4)	已執行(註1)				未執行(註2)			
						認股數量	認股價格	認股金額	取得認股數量占已發行股份總數比率(註4)	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率(註4)
經理人	副總經理	賴建宏	2021.11.15	79,000	0.07%	59,250	29.9	1,772	0.05%	19,750	29.9	591	0.02%
	處長	林傑倫											
	副總經理	葉錫銘											
	處長	洪詳竣											
	處長	張正彥											
	會計主管	曹瑞龍											
	財務主管	盧佳慧											
員工	經理	黃嘉修	2021.11.15	98,000	0.09%	73,500	29.9	2,198	0.07%	24,500	29.9	733	0.02%
	經理	楊智創											
	經理	黃嘉修											
	經理	林祐辰											
	經理	林勝雄											
	經理	何青德											
	副理	趙冠宇											
	副理	呂國輝											
	副理	孟存毅											
	副理	林文斐											
副理	張光亮												

註1：包括經理人及員工（已離職或死亡者，應予註明），應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露其取得及認購情形。

註2：欄位多寡視實際發行次數調整。

註3：取得認股權憑證可認股數前十大員工係指經理人以外之員工。

註4：已發行股份總數係指經濟部變更登記資料所列股數。

註5：已執行之員工認股權認股價格，應揭露執行時認股價格。

註6：未執行之員工認股權認股價格，應揭露依發行辦法計算調整後之認股價格。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形

(一)最近年度及截至年報刊印日止，已完成併購或受讓他公司股份發行新股情形：無。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：本公司於 2022 年 07 月發行國內第三次無擔保轉換公司債，其發行計畫之內容、執行情形及產生效益，請詳公開資訊觀測站 (https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/bfhtm_q2)，輸入公司代號及年度。

肆、營運概況

一、公司之經營

1. 業務內容

(1)本集團所營業務主要範圍含，半導體封測、玻璃基板（Glass Substrate）、LED 封測、印刷電路板(FPC)製程、被動元件製程及通訊產品之生產相關設備，茲依照公司別分述如下：

A. 母公司－鈦昇科技

- a. 雷射打印、雷射切割等自動化設備研發製造及銷售。
- b. 雷射應用設備研發製造及銷售。
- c. 電漿清洗機研發製造及銷售。
- d. 玻璃基板（Glass Substrate）自動化設備研發製造及銷售。
- e. 軟板設備研發製造及銷售。

B. 子公司

(1) 子公司－唐威科技

軟性印刷電路板製造與銷售。

(2) 子公司－鈦昇半導體材料

SMD 包裝材料買賣業務。

C. 孫公司

(1) 孫公司－東莞鈦昇及無錫鈦昇

半導體 / LED / 被動元件之包裝載帶設計及製造。

(2) 孫公司－辰鈦貿易(上海) 及江蘇鈦晟

自動化設備製造、銷售及售後服務。

(2) 營業比重

單位：新臺幣仟元

類別	主要產品	2023 年度		2024 年度	
		收入淨額	比重(%)	收入淨額	比重(%)
半導體設備	雷射設備	743,206	47.97	870,668	52.93
	電漿設備	102,802	6.64	167,578	10.19
半導體材料	SMD 包裝材料	307,822	19.87	304,781	18.53
其他		395,544	25.52	301,881	18.35
合計		1,549,374	100.00	100.00	100.00

(3)公司目前之產品項目：

主要產業類別	產品類別	主要產品	重要用途或功能
半導體設備	雷射設備	雷射打印機	*IC 元件、LED 元件打印供製程履歷追溯及辨識 *晶片打印及晶圓二維碼
		雷射圖案劃線機	*軟板或玻璃 ITO 觸控線路製作、銀漿線路製作
	雷射切割機	*穿戴式元件切割製造 *SIP IC 切割製造 *藍寶石切割製造 *強化玻璃切割製造 *陶瓷基板切割製造 *軟性印刷電路板切割製造	
	雷射鑽孔機	*LED 陶瓷基板鑽孔 *3D IC 基板鑽孔 *智慧手機玻璃屏幕鑽孔 *玻璃基板改質、通孔 *ABF 載板鑽孔	
	電漿設備	電漿清洗機	*IC 封裝導線架清洗 *IC 封裝基板清洗 *晶圓相關製程前清洗 *車載、面板顯示器清洗 *ABF 載板清洗
		晶圓級封裝電漿加工設備	*晶圓切割 *晶圓微蝕刻
其他(備品)	零組件及專業維修服務	*上述設備之備品更換及維修收入	
電子零組件產品	軟性電路板	觸控面板相關之軟性電路板及模組件設計與製造	*使用於手機、筆電及 3C 通訊產品
	SMD 包裝材料	半導體/ LED /被動元件之包裝載帶及蓋帶設計與製造	*表面黏著元件 SMD 之裝載、保護

(4)計畫開發之新商品：

- A.玻璃基板相關製程設備
- B.晶圓電漿微蝕刻設備
- C.先進封裝製程設備
- D.第三代半導體相關應用設備
- E.大尺寸電漿清洗設備
- F.矽光子共同封裝技術設備

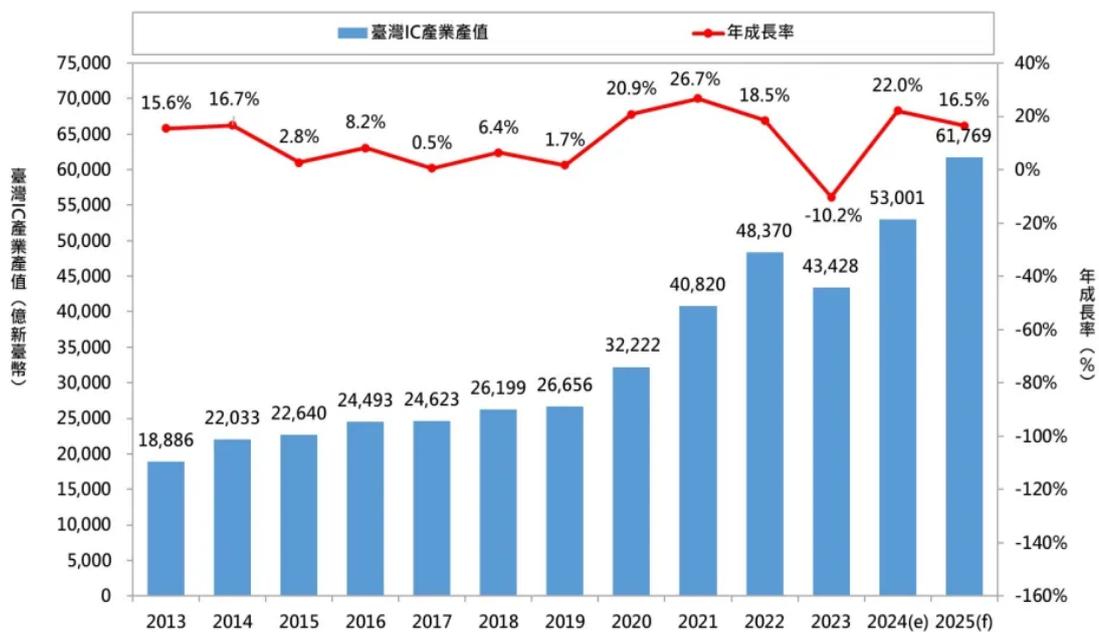
2. 產業概況

(1) 產業之現況與發展

A. 台灣半導體產業概況

隨著全球經濟復甦與AI人工智慧驅動，2024年，台灣半導體產值將突破新臺幣5兆元，年增22%，超越全球市場平均表現。終端市場買氣逐步回溫，加上AI新興應用需求攀升，不斷引領半導體產業快速成長。根據世界半導體貿易統計協會（WSTS）預測，2024年全球半導體產值預計將達6,112億美元，年成長16.0%；2025年更將成長至6,874億美元，年成長12.5%，反映市場強勁表現。

工研院產業科技策略所指出，國際全球半導體產業走向也受到各國政策深遠影響，美國晶片法案、歐盟晶片法案，及臺灣和日本等產業發展計劃，正在重塑全球半導體供應鏈的生態系。臺灣作為全球半導體製造的核心重鎮，在政策支持和技術創新下，將繼續扮演關鍵角色。2025年臺灣半導體產業預估產值將突破新臺幣6兆元，年成長率為16.5%；若從臺灣IC設計業、製造業、封測業等三大次產業來看，2025年均將有兩位數成長(如圖一)，持續推動臺灣IC產業邁向新紀元。



圖一、2024年臺灣IC產業正式突破5兆元關卡，年成長預估達22.0%。(資料來源：工研院產科國際所，2024/10)

B. 半導體設備產業概況

SEMI國際半導體產業協會於 SEMICON West 2024 北美國際半導體展，公布年中整體 OEM 半導體設備預測報告，預估 2024 年全球半導體製造設備銷售總額將較去年同比增長3.4%，攀上 1,090 億美元新紀錄，成長力道也將延續至 2025 年，在前、後段製程需求共同驅動下，銷售總額可望再創歷史新高，來到 1,280 億美元。(如圖二)

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸分析：「半導體製造設備總銷售額今年的成長曲線延伸至 2025 年將進一步擴大，強勁增長約 17%。全球半導體產業用以支持 AI 浪潮中各式顛覆性應用的強大基礎和成長潛力。」半導體產業正處於關鍵時刻，擴產投資推進與主流技術的發展，滿足不斷演進的全球產業需求。生成式 AI 與高效能運算，正在推動先進邏輯與記憶體領域的進步，而主流製程則繼續支撐汽車、物聯網和功率電子等關鍵應用。若依地區劃分，中國、台灣和南韓2025年仍將居設備支出前三強的位置。今年設備運往中國的出貨金額預計將超過創紀錄的 350 億美元。但中國在過去三年進行大量投資後，預計 2025 年將出現萎縮。

半導體需求偏向AI，智慧手機需求失速，加上各國政府祭出半導體振興政策、廠商提前進行投資。據國際半導體產業協會(SEMI)表示，當前全球半導體工廠稼動率約7成、低於被視為健康水準的「8成」。加上產能出現過剩跡象，迫使各家半導體廠商修正設備投資。英國調查公司Omdia分析師南川明表示，「中國新工廠投資速度放緩、2025年全球半導體投資很有可能將持續減少」。

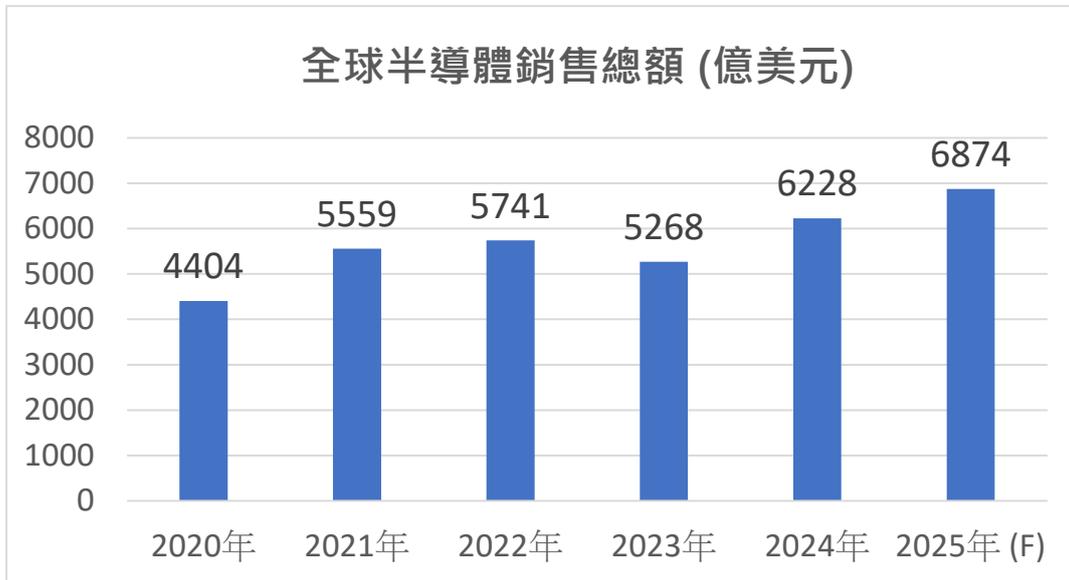


圖二、全球半導體製造設備銷售總額 (資料來源：SEMI 國際半導體產業協會 · 2024/07)

C. 全球半導體產業概況

世界積體電路協會(WICA)表示，2024年全球半導體市場預計達到6112億美元，年增17%，全球市場已觸底反彈，即將進入週期上行階段。中國市場規模成長最快，美國次之，中、美兩國成長較2023年同期成長分別為20.1%及18.2%。中國大陸是全球最大電子設備製造地區，仍是全球最大積體電路市場，預計2024年中國大陸半導體市場規模約1865億美元，佔全球半導體市場30%。

SEMI 國際半導體產業協會於近期公布的最新一季全球晶圓廠預測報告中指出半導體產業 2025 年將有 18 座新晶圓廠啟建，包括三座 8 吋和十五座 12 吋晶圓廠，其中大部分廠房可望於 2026 年至 2027 年間開始運營量產。根據 2024 年第四季全球晶圓廠預測報告，全球半導體產業於此期間將有多達 97 座新建高產能晶圓廠投產，包括 2024 年啟用的 48 座和 2025 年啟用的 32 座廠房，晶圓尺寸則從 12 吋到 2 吋不等。

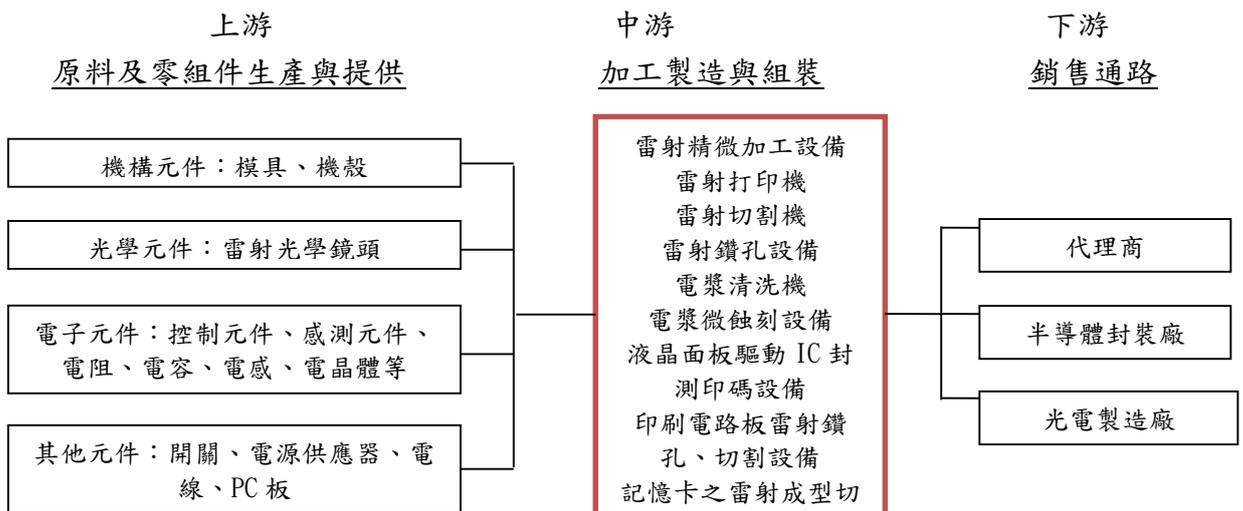


圖三、全球半導體銷售總額 (資料來源：WICA 世界積體電路協會)

(2) 產業上、中、下游之關聯性

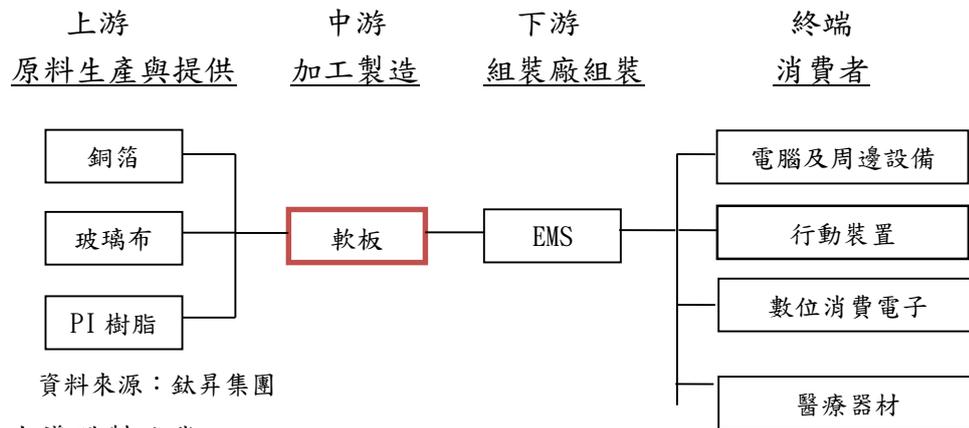
本集團產品產業之上、中、下游關聯性列示如下：

A. 電子及半導體生產設備製造業

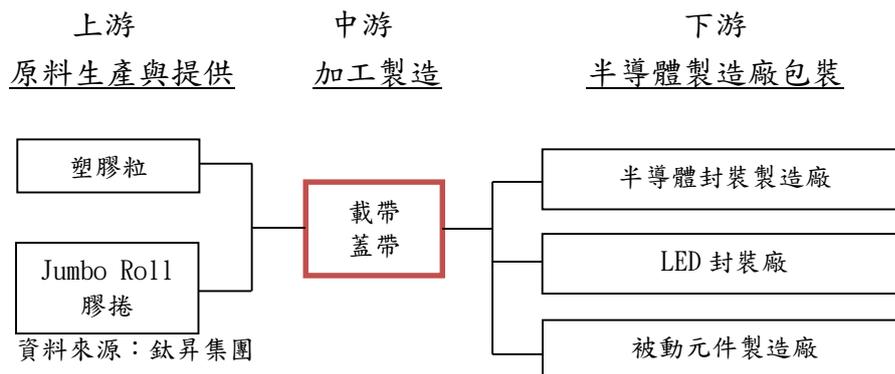


資料來源：鈦昇集團

B.軟性電路板製造業



C.半導體製造業



(3)產品之各種發展趨勢

1. AI 人工智慧契機

生成式 AI 對高速運算能力和資料處理能力的倚賴，直接帶動高效能運算 (HPC) 半導體市場需求，先進技術為生成式 AI 及高速運算提供了強大支援。預估 2025 年半導體市場營收預估有 8%~12% 成長，也帶動資本支出同步推高，尤其是與 HPC 相關的先進邏輯製程及先進封裝，全球半導體產值預計在 2030 年達到 1 兆美元，其中 AI 相關半導體將占整體成長的 50% 以上。

2. 先進封裝市場

AI 人工智慧浪潮席捲全球，半導體先進封裝技術需求大幅提升，從先進封裝 (CoWoS)、面板產業延伸的扇形封裝 (Fan-out) 到高頻寬記憶體 (HBM) 多層堆疊封裝等新興技術；先進封裝技術是將複數晶片用水平或垂直之排列方式進行封裝，進而提升整體電晶體密度。隨著科技進步，封裝技術已從單一晶片進化為可將複數晶片整合，達到更高電晶體密度、更高效能的先進封裝技術，未來幾年內台灣先進製程的投資持續領先全球。

3. 玻璃基板技術與研發

玻璃基板 (Glass Substrate) 是替代傳統有機基板，可以形成更精細的電路，加上耐熱和抗彎曲特性，有利於高階產品應用。半導體封裝技術開始由 2D 走入 3D，透過晶片堆疊封裝，持續推升電晶體數量，取得更好的效能，輝達 (NVIDIA)、超微 (AMD) 和英特爾 (Intel) 預計最快於 2026 年採用玻璃基板。

4.晶圓電漿切割設備

晶圓切割通常使用刀片技術加工進行，然而刀片寬度也讓晶圓去除寶貴的「空間」，除此之外亦可能導致晶片碎裂或破裂，良率降低。為了改善侷限；透過電漿切割致力於縮小切割道，增加每片晶圓可獲取的晶片數量，及對應各種形狀設計切割，提升晶粒切割後強度。

5.矽光子技術引發高速互聯革命

AI 浪潮掀起海量資料高運算能力需求，矽光子及共同封裝光學元件，將成為突破摩爾定律瓶頸的關鍵，而今矽光子技術應用預計 2025 年將完成整合，逐年步入成長軌道，生成式 AI 對伺服器效能帶來極大考驗，尤其是在資料傳輸環節，不管是主機板上的晶片互聯，或是運算叢集內的互聯，都需要頻寬更大、功耗更低的介面技術來實現。頻寬更大、距離更遠且更加省電的矽光子，也因此成為備受矚目的關鍵技術。

(4)產品之競爭情形

全世界的智慧型通訊電子產業發展迅速，鈦昇科技是專業於半導體、高階基板材料、LED、被動元件等高階自動化設備與SMD包裝材料設計與製造之科技公司。鈦昇及其子公司之主要產品係為雷射打印機、雷射精微加工機、雷射切割機、雷射鑽孔機、雷射劃線機、雷射玻璃鑽孔機、電漿清洗機、電漿切割機、FPC製程設備及SMT精密包裝載帶。

其中，雷射打印機、雷射精微加工機、雷射切割機、雷射鑽孔機、雷射劃線機為鈦昇及其子公司提供的雷射解決方案。雷射打印機為較早開發的產品，現可針對不同材質產品進行打印，客戶市場集中亞洲地區。然由於智慧手機及穿戴式產品的上市推波助瀾之下，傳統精密加工技術已無法滿足更精微之需求，精密微加工便成為解決此需求的重要技術，雷射微加工技術便大量被需求。鈦昇及其子公司延續雷射應用技術，研發已擴展至雷射切割、雷射鑽孔及雷射線路製造之設備，並運用於薄晶圓、穿戴式產品、陶瓷基板、玻璃基板等元件之切割或鑽孔，因應異形切割在智慧型手機、穿戴式產品的趨勢及矽光子共同光學封裝（CPO）的崛起，引導雷射應用廠商的投入，目前主要的競爭者來自美國、日本、德國與台灣本地。

電漿切割機方面，主要係在真空下進行乾式蝕刻，將晶圓製作成晶粒(晶粒化)的加工技術，由於可同時加工晶圓上的所有切割道，因此即使是小晶粒元件也可維持高UPH。再加上可對應逐漸狹窄的切割道，所以晶粒取得的數量也可能提升。另外還有可對應各種形狀的加工、高潔淨度製程、以及晶粒強度的提升...等優點。

電漿清洗機方面，鈦昇及其子公司為台灣最早開發此技術應用設備並作為IC封測產業用途之廠商，應用於IC半導體封測及LED封測，搭配製程技術改善客戶的封裝品質，競爭者主要來自美國及日本廠商。近日因應環保、奈米科技趨勢抬頭，需搭配不同技術，我們在不同產業提供的服務也佔有一席之地。

FPC製程設備方面，FPC製造業是智慧型手機、平板電腦產業發展下的重要族群，為了使智慧行動裝置達到輕、薄、短、小的需求，軟性電路板的使用需求大幅提升。鈦昇及其子公司目前提供不同製程的自動化設備，在乾、溼設備製程基礎上，

陸續提供高附加價值的設備與服務，如：壓合、成形、開蓋、電鍍等。

載帶產品相對以上設備是成熟市場，競爭者眾多，又以中國大陸之競爭工廠採用削價競爭的方式來取得市佔率，對於其他競爭者皆是潛在的威脅。其中表面黏著元件(Surface-Mount Device，簡稱SMD)在製程上具高度自動化特性，所使用封裝材料品質除影響生產過程，對SMD品質亦有重大影響，目前SMD包裝材料無論單價高低，材料品質及信賴性為各電子元件廠商最關注的重點，品質也因此是鈦昇及其子公司之重點與機會。鈦昇及其子公司以高精度及細微產品進行投資與做為發展方向，對於鈦昇及其子公司而言，競爭者為美、日之廠商。

3.技術及研發概況

(1)所營業務之技術層次

A. 雷射打印及切割系統的應用技術

雷射打印機及切割機主要以台灣本地的高精密機構另組件製造，佐以PLC(可程式控制器Programmable Logic Controller) 和PC Base 控制系統，透過人機介面的技術及高速伺服控制，更精準的達到精密加工主、被動元件，完成單機自動功能；其次再以機電系統的整合，結合網路整合控制，將多機台連線控制達到精密測量、分析技術的目的，使製造管理者得以快速取得技術整合資訊，作為提昇管理技術能力的利器。另因產品日趨微細，加工精密度要求甚高，設計及製造嚴謹要求，本集團的產品提供定位精度高、可應用多種材質、針對單個產品檢測的特色，使雷射打印與切割成為本公司的強項。近年來更取得雷射加工之集塵裝置、晶圓整平裝置、晶圓雷射切割機台、晶圓整平吸盤結構等專利，並與歐、美、日同類型之公司競爭。

B. 雷射鑽孔與開槽的應用技術

由於智慧型手機與智慧車帶動CIF感測器的使用量，雷射鑽孔的技術被日益重視。由於本集團的強項在於將待鑽孔的產品經過蝕刻，可使加工品近乎無缺陷與崩裂。此外，目前的技術層次不但的精度高，也提供比傳統更快的加工速度；雷射開槽，本集團又分為兩個應用層面：寬溝槽應用與深溝槽應用，本集團的優勢在於技術可適用多種材料，使用冷加工的方式減少加工的缺陷與崩裂，維持加工品的品質，並可搭配電漿清洗與乾冰清洗的需求，供客戶多樣化的服務。

C. 視覺檢視系統技術

雷射打印機和切割機利用視覺檢視(vision)，作產品精密定位及品質檢測，此技術係善用光電產業技術(CCD)及感測器的技術，快速取放被測試的產品，達到品質管理的功效。此一技術結合打印機或切割機後可以降低成本，並達到一機多用的功效。

D. 電漿清洗應用技術

電漿清洗係利用真空乾式洗淨技術，配合精密模具設計開發，有效的運用到IC封裝業及LED封裝業之前、中、後段製程的清洗製造。本集團電漿清洗的優勢

在於市場上無完全的替代方案，且為製程上最有效的方式。近年來，電漿清洗的應用技術廣泛，也可運用於其他LED 及機板製造的清洗，或紡織及奈米技術兼具環保效果。此技術較濕式洗淨技術品質大幅提高，滿足客戶需求。本集團另一優勢為：溫度控制，此為電漿清洗應用的重點，藉以降低對產品的破壞，提供更高品質的服務。

E. 軟性電路板的應用技術

除了與國外光學大廠合作，這幾年來積極開發卷對卷的生產製程，並導入實際生產及銷售，為客戶提升生產良率及成本優勢。2014 年來新開發更先進的雷射鑽孔製程技術及卷對卷真空沖壓機，進而提升本集團設備於市場上的競爭力。

F. 軟性印刷電路板製造

本集團軟性印刷電路板未來主要開發技術，將致力於窄間距軟板開發，以及多層板及軟硬接合板之技術開發。

G. 微小尺寸包裝載帶之高速精密生產設備開發

本集團因應不同客戶之需求，擁有圓型模、平板模、一貫生產設備外，因應微小尺寸之產品需求，整合雷射、沖切及光電檢測之技術，投入及開發此生產設備。本集團確保其相容性及高品質的產品，滿足客戶在儲存及運輸過程中，保護組件的需求，並對於客戶各種單量或尺寸大小及精密度不同的載帶需求均能充分滿足，擴大營業及利潤規模。

(2)研究發展人員與其學經歷

本集團研發人員主要係擁有大專以上之學歷，其中碩、博士學歷者達41.98%，截至2025年3月31日止，研發人員共計131人。

年度 學歷	2023年底		2024年底		2025年3月31日止	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
碩士以上	68	44.16	60	42.55	55	41.36
大學(專)	85	55.19	80	56.74	77	57.90
高中	1	0.65	1	0.71	1	0.76
合計	154	100.00	141	100	133	100

(3)最近五年度每年投入之研發費用

單位：新臺幣仟元

項 目	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度
研發費用	151,771	159,650	208,505	207,420	252,464
營業收入淨額	2,040,567	2,544,782	3,222,998	1,549,374	1,644,908
佔營收淨額比例	7%	6%	6%	13%	15%

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告。

本集團每年投入之研發費用皆佔集團營業收入淨額之6%以上，預計未來每年的研發費用投入皆維持或高於營業收入淨額之6%。

(4)開發成功之技術或產品

最近五年度主要開發成功之技術與產品

年度	開發成功之技術及產品	研發內容	應用領域
2018	B3000 Plus 大尺寸面板雷射打印機	1.QC 攝像系統管理打印品質 2.雙頭雷射與高彈性上下料盒	Laser Panel Marking
	Backside wafer Laser scribing 晶圓級背面化線機	1.精密的平台. 2.正背面的定位系統. 3.飛秒雷射.	12" wafer backside Laser Scribing
2019	Substrate compound Laser marking 封裝基板雷射蓋印機	1.雙雷射蓋印控制. 2.高解析,大視野蓋印品質檢測	TWIN LASER Marking+AOI
	On tray Laser marking (with PMI QC, PnP) 載盤式雷射蓋印機	1.多置載盤進出料設計. 2.產品序號檢測資訊整合. 3.線掃描快速定位.	On tray Laser Marking
2020	Laser Grooving system, Si Wafer 晶圓級雷射開槽機	1.雷射微細加工技術. 2.精密運動控制. 3.旋轉塗佈技術	Laser low-k grooving
	Laser Dicing System Si Wafer 晶圓級雷射切割機	1.超快雷射控制技術. 2.光.機.電整合控制.	Laser wafer dicing
	Laser Drilling System ,Si Wafer 晶圓級雷射鑽孔機	1.雷射光斑調度技術. 2.加工路徑最佳化技術. 3.多光束分光技術.	Laser drilling
	SIP Laser cutting (substrate type) 系統封裝式雷射切割機	1.產品切割雷射聚焦動態控制. 2.切割開槽蓋印製程整合. 3.高精度產品工作平台.	SIP UV Laser cutting
2021	Laser Dicing System , Glass Wafer 玻璃晶圓雷射切割機	1.Bessel beam 光路設計. 2.加工路徑最佳化技術. 3.光斑整形技術開發	Laser glass cutting
2022 ~ 2024	Laser Via drilling system 精密微細孔徑雷射機	1.晶圓級/面板級扇出封裝鑽孔 2.高速雷射鑽孔光路技術	ABF drilling
	Plasma Dicing 電漿切割機	1.高速率切割製程開發 2.自動生產真空腔體設計	Silicon wafer cutting, Hardness wafer cutting
	TGV 雷射改質	1.超高速改質加工技術	Through glass via

4.長、短期業務發展計畫

(1)短期發展計畫

- A. 增加銷售服務據點及行銷通路，除原有之大陸及東南亞市場持續深耕外，並積極拓展歐美及東北亞市場，目前皆已與客戶持續配合中。本集團將會繼續推出新產品深耕現有客戶，並將原有產品增加新行銷通路往全球大廠推進。
- B. 健全代理商銷售支援體系，充分與貿易夥伴合作，健全行銷通路。

- C. 持續研發改善生產技術、降低成本，積極開發各項有利基之新產品，以公司現有規模為基礎，研發多元性產品，並將核心領域向不同產業延伸，以掌握市場商機。
- D. 人才透過建教合作、參與高階人才培訓計畫，及申請替代役等方式擴大人才網羅之管道。加強人才之專業培訓，密切與研究機構和學術機構交流。此外，內部進行研發績效評估與獎勵制度，留任並爭取優秀人才以提升研發部門的實力。
- E. 推動上櫃公司之投資人關係，增加公司知名度以網羅優秀人才加入。
- F. 加強 ERP 有效管理應收帳款及存貨庫存，並藉由主動向客戶服務增進客戶驗收速度，加快應收帳款及存貨周轉率。

(2)長期發展計畫

- A. 配合人工智慧、5G 網路、物聯網、VR/AR 應用等趨勢之興起，配合本集團之專業技術-精微雷射加工技術及精密電漿表面處理技術，開發藍海市場，成為公司將來獲利之利器。
- B. 提供符合不同階層之產品，並經由企業識別系統，推廣公司高科技形象，以提昇知名度，創造較高附加價值與市場佔有率。
- C. 掌握市場動向，對既有的產品加強銷售力度，以擴大市場規模；對於新開發的產品選定有潛力的客戶積極進行推廣配合之工作，除不斷地精進與研發本身產品的技術外，更進一步協助客戶縮短其產品開發的時程。
- D. 提高產品品質並強化售後服務，在經營上持續秉持永續經營的理念，建立企業優良文化。
- E. 發展 ESG 永續經營，重視環境保護、積極實踐社會責任及落實公司治理...等。

二、市場及產銷概況

1.市場分析

(1)主要商品(服務)之銷售(提供)地區

本集團主要產品為半導體製造設備、軟性電路板製造設備、軟性電路板、半導體包材及電子材料等，主要銷售地區如下：

單位：新臺幣仟元；%

銷售地區	年度	2023 年度		2024 年度	
		金額	比重%	金額	比重%
台灣地區		357,632	23.08	637,972	38.78
中國大陸及其他地區		1,191,742	76.92	1,006,936	61.22
合計		1,549,374	100.00	1,644,908	100.00

(2)市場未來之供需狀況及成長性

A. 5G 應用時代來臨

受 5G 帶動半導體晶片升級，和晶圓廠建設的推動，封測市場規模穩步成長。對於設備商來說實為一大成長機會。然而，機會亦伴隨著考驗：隨

著產品輕薄化卻須含有更多的功能。因此，製程的設備要能夠精密的執行每一個步驟，並維持產出品的良率。又因人工智慧的發展，設備商亦須結合控制與 IT 技術，以發展智慧製造加工系統，以下為彙整市場發展的方向。

(A) 專業分工化

IC 製程上漸以專業分工為導向，與過去 IDM 的模式相比，每個製程步驟的廠商數量提升，所需進行封測的重點亦不相同，對於設備商而言，配合客戶需要，在有限腹地內需增加更多的機台，其設備統一規格化、標準化及可變式設計乃是增進省空間化方式，其為未來發展方向。

(B) 高自動化技術

因應製程機台需求提升，其擴增機台時會增加成本。因此，對於設備商而言，能幫助廠商有效減少耗能及提升加工效率是未來趨勢，提供高自動化的技術使獲利增加。

(C) 技術精密化

因摩爾定律的限制以及產品的複雜度越來越高，並因應近年 IoT 高速成長使 SiP 成為未來幾年的主流趨勢，其廠商競爭的關鍵在於其 IC 能力。因此不論是在封裝或封測上，製程須更精密及準確，對於設備商而言，精密度與準確度為未來設備研發的方向。

B.發展多元化產品，以擴大產品應用範圍

現今終端 3C 消費產品走向輕、薄、短小及多功能化，各行各業均希望以最低的成本取得最大的功能，半導體封裝廠及軟性印刷電路板製造廠勢必大受其影響，並迫切希望購置之機台能一機多用，縱使未來需求變動仍可透過設備升級完成進化，以鈦昇集團為例：該集團透過子公司一唐威公司發展軟性電路板製造業以充分了解行業未來性，以利能確保終端產品之未來性，母公司可即時開發最新需求之設備，透過孫公司一東莞鈦昇及無錫鈦昇發展半導體製造業中封裝後所需 IC、LED 及被動元件所需之包裝載帶及蓋帶，提供其客戶半導體封裝廠最佳之整合服務，而雷射相關設備更往一機多用方向發展，雷射打印機不僅做為半導體封裝過程畫印條碼以利追蹤外，更於系統中做出區隔，以利客戶能於最短時間確認產品狀況，相關設備更可採模組化，更換不同雷射頭即可進行劃線或切割，以利客戶縱使在不景氣狀態下，減少資本支出時仍可利用更換或升級方式加大機器之應用範圍。

近日產品應用除原先半導體生產、製造等產業鏈外，在精準醫療與數位醫療的前景，及國際環保經濟意識的抬頭，其核心技術向環保、生醫等方向延伸。可將半導體技術應用於生醫產業，突破既有技術，提供醫療領域創新的測試設備以協助新藥開發。利用半導體的技術開發不同領域使用之設備為未來設備商新的藍海市場。

C.智慧設備規格化

結合國內軟體資源發展智慧軟體模組，開發精度與效能監測補償之智慧機械，使設計之參數能夠符合製程需求，如自動光學檢測-建立生產決策支援之智慧製造系統，發展全面自動化及規格化，使相同規格產品都能夠一致解決多數製程上的問題。以本集團為例：雷射蓋印機與切割機利用視覺檢測，作為產品精密定位及品質檢測，善用光電產業技術(CCD)及感測器的技術，快速取放被測試的產品，達到品質管理的功效。透過系統智能化，在未來能協助廠商降低成本達到更好的效率，對於本集團而言，亦提升了設備附加價值以增加產品競爭力。

(3)競爭利基

A.優越的國際行銷能力

本集團在國內半導體生產設備市場上，除與國外大廠合作，發展具競爭力的產品以作為長期代理關係外，並與代理商建立良好互惠的合作關係，目前已順利推展東南亞及中國大陸之行銷、製造及售後服務據點。而LED製程設備方面，客戶以國內/大陸LED大廠為主，同時提供迅速、即時及完善的售後服務。在包裝載帶部分，亦在中國大陸華中與華南地區位占有一席之地。

B.高品質多樣的產品

本集團自動化多功能設備除IC封測廠設備外，LED及FPC設備已開發完成；觸控面板相關之軟性電路板及模組件方面，藉由引進策略夥伴以進行上下游的整合；半導體/LED/被動元件之包裝載帶設計及製造，由於客戶層多元，為滿足各類客戶載帶需求，就客戶所需求的產品尺寸設計開發模具生產載帶達到客戶需求。

C.即時反應的客服系統

本集團具有完善的售後服務及即時駐點服務，迅速提供在地服務，可於最短時間內開發滿足客戶需求。售後服務維修人員之經驗豐富，並對客戶產品之生產製程深入研究，協助客戶解決製程及設備上之問題，以提升產品之精密度及良率。

D.完善供應鏈整合能力

本集團零組件體系架構完備，與供應商配合良好，除少數關鍵零組件由兩家以上國外供應商供應，貨源穩定不致缺料外，絕大部分係由國內廠商供應；組裝加工件亦由國內專業的協力廠商生產供應，故供應鏈建構完整，生產成本亦降低。

(4)發展遠景之有利、不利因素與因應對策

A.有利因素：

(A)產業精密化需求

隨著3C產品、光學零件的輕薄短小趨勢，半導體製造業生產設備的精密度需求程度也日益增加，本公司於雷射應用科技及精密機械設備深耕二十

餘年，藉由長年累積關鍵技術及研發創新能力，創造其優越的整合能力，將目前最先進之雷射飛秒技術整合於 IC 微加工製程，並不斷改善精密度及增進設備穩定性及加工速度，品質佳深獲國內外大廠肯定及採用。

(B)優秀業務及研發團隊

本集團業務、客服人員及研發團隊長期投入設備機台製造領域，不斷累積製造及服務經驗，並不斷累積業界客戶人脈資源及適時了解客戶需求，有助於機台設備之研發，及滿足客戶之各式需求。

(C)快速且即時服務效率

本集團為就近服務客戶，於國內客戶聚集處及東南亞地區分別設立北、中、南辦事處及泰國曼谷、馬來西亞檳城及菲律賓馬尼拉服務據點，提供 24 小時即時維修服務；更於中國大陸透過轉投資事業，積極布局並提供最即時服務。

B.未來發展之不利因素及因應對策：

(A)需要不斷投入大量研發資金以保持競爭力

本集團所處產業屬於技術密集產業，且市場環境變遷迅速，須不斷投入研究發展資金及培植研發技術團隊，以因應不斷成長與革新之市場。

具體因應措施：

充分取得主要投資者對投入研發之支持，並不斷累積公司競爭力，增進投資者對公司之信賴度，另強化於資本市場籌措長期穩定資金之能力，持續提升研發能力及技術水平，強化國際競爭力。

(B)產業特性造成應收帳款帳齡較長，不利資金運作

機台設備業依照交機與驗收完成收款，驗收期間有時長達一年，產業特性造成應收帳款帳齡較長，不利資金周轉。

具體因應措施：

本集團近年來持續加強應收帳款之管理及催收，並不斷研發高精密設備，創造市場獨佔性，以提升與客戶間議價能力，積極改善交易收款條件。

(C)大陸人工成本逐漸提高

過去因國內人工成本較高，為降低經營成本，本集團將 SMD 電子包材移往人力成本較低之中國大陸，且為了提供半導體設備客戶即時的服務，亦於中國大陸設立服務據點，近年來隨著中國大陸保障其人民逐年提升人民最低薪資，逐漸墊高子公司營運成本，成本之持續增加將會壓縮獲利空間。

具體因應措施：

為降低人工成本提供帶來之衝擊，本集團於大陸之轉投資積極運用自動化設備，以降低人工成本上升帶來之影響，並自行研究發展 SMD 包

裝材料製造高速自動化設備，以達成本集團內部營業綜效。

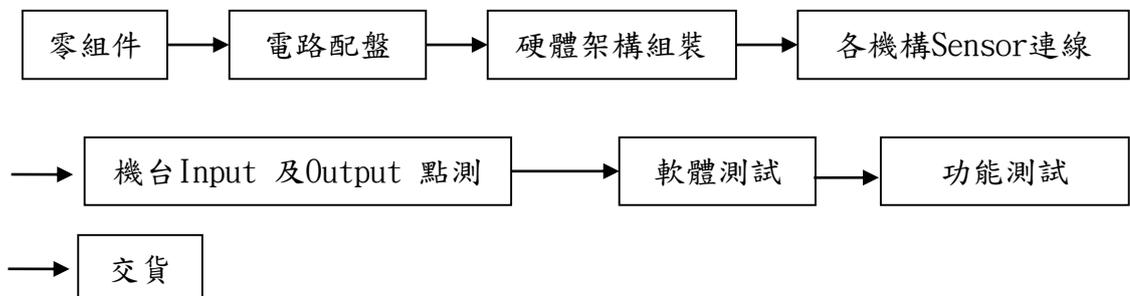
2. 主要產品之重要用途及產製過程

(1) 主要產品之重要用途

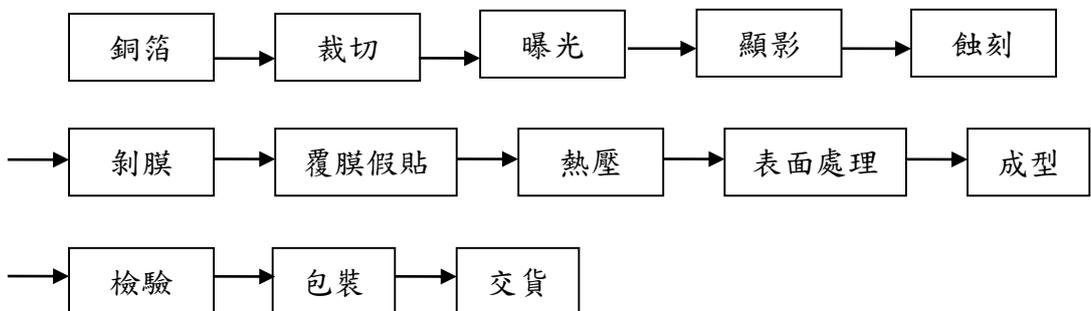
- A. 雷射打印機用於 IC 封裝測試製程末端的識別機器。
- B. 雷射精微切割機使用於半導體元件之成型製造。
- C. 電漿清洗機用於 IC、LED 製程中的清洗。
- D. 電漿微蝕刻設備用於晶圓切割微加工產品製程。
- E. SMD 包裝材料用於 IC 產業、二極體產業、被動元件產業、LED 產業等元件之包裝。

(2) 主要產品產製過程

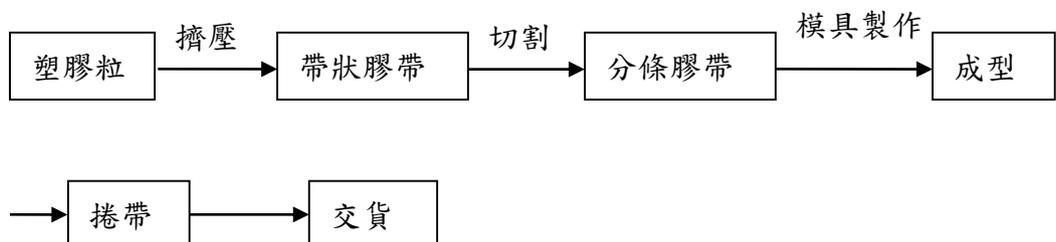
A. 自動化設備製程



B. 軟性印刷電路板製程



C. SMD 包材製程



3. 主要原料之供應狀況

本公司產品之主要原物料為雷射源、雷射光路元件，RF 真空產生器、匹配器、PUMP 及塑膠捲等，供應廠商眾多，但對各廠商之進貨比重均不高，並無進貨來源過度集中之情形。此外，本公司與供應商多能維持長期良好之合作關係，

惟為確保供貨來源之穩定性，尚與其他供應商保持聯繫，其供貨狀況良好，未曾有供貨短缺或中斷之情事。

4.最近二年度主要產品別或部門別毛利率重大變化之說明

單位：新臺幣仟元

項目	年度	2023 年度	2024 年度	增減變動	變動比率(%)
	營業收入		1,549,374	1,644,908	95,534
營業毛利		614,281	597,644	(16,637)	(2.71)
毛利率(%)		39.64	36.33	(3.31)	(8.35)
毛利率變動達 20%之說明：變動未達 20%					

5.主要進銷貨客戶名單

(1)最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例：

單位：新臺幣仟元

項目	2023 年度				2024 年度				2025 年度第 1 季			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占 2025 年度第 1 季進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	甲公司	128,986	14.38	無	甲公司	172,377	17.90	無	甲公司	11,203	5.71	無
2	其他	768,258	85.62	無	其他	790,782	82.10	無	其他	185,146	94.29	無
	進貨	897,244	100.00	—	進貨淨額	963,159	100.00	—	進貨淨額	196,349	100.00	—

增減變動原因說明：

兩年度最大供應商相同未有變動。

(2)最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例：

單位：新臺幣仟元

項目	2023 年度				2024 年度				2025 年度第 1 季			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占 2025 年度第 1 季銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	B 客戶	628,157	40.54	無	A 客戶	353,794	21.51	無	A 客戶	80,873	25.68	無
2	A 客戶	141,087	9.10	無	B 客戶	306,719	18.65	無	B 客戶	26,821	8.52	無
3	其他	780,130	50.36	無	其他	984,395	59.84	無	其他	207,219	65.80	無
	銷貨	1,549,374	100.00	—	銷貨	1,644,908	100.00	—	銷貨	314,912	100.00	—

增減變動原因說明：

主要受各年度銷售客戶資本支出擴廠需求而有所變動。

三、最近二年度及截至當年度4月底止從業員工人數：

年 度		2023年度	2024年度	2025年截至4月底止
員 工 人 數	直接人員	163	165	187
	間接人員	416	391	374
	合計	579	556	561
平 均 年 歲		39	40	40
平 均 服 務 年 資		7	7	8
學 歷 分 布 比 率 (%)	碩士以上	16.59	6.80	6.87
	大學(專)	48.64	47.91	47.58
	高中	16.67	21.07	18.54
	高中以下	18.10	24.22	27.01
	合計	100.00	100.00	100.00

四、環保支出資訊

1. 依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：不適用。
2. 防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：不適用。
3. 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司改善環境污染之經過，其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：無。
4. 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因污染環境所受損失(包括賠償)，處分之總額，並揭露其未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)：無。
5. 目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：不適用。

五、勞資關係

1. 列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形。

本公司平時即強調勞資之雙向溝通，並重視員工之各項福利，茲說明如下：

(1) 員工福利措施

- A. 結婚/生育/喪葬/旅遊/生日等補助金。
- B. 公司員工除加入勞健保外，公司另有團體保險及定期舉辦員工體檢。
- C. 員工認股、員工紅利及員工績效獎金均依照公司章程及相關辦法施行。
- D. 定期或不定期舉辦員工教育訓練，內訓或外訓均可提出申請，以提高員工專業技能。
- E. 員工依照服務年資享有特別休假。
- F. 公司另設立「職工福利委員會」，推行員工福利及舉辦旅遊活動，並且協助設立社團與提供經費補助。

(2)進修與訓練

本公司為鼓勵員工進修，充實知識，訓練其應用智能，藉以提供工作效率。得隨時舉辦下列事項，其詳細辦法可參考”教育訓練管理辦法”

- A.釐定並實施各項新人訓練與管理、專業...等業務訓練。
- B.選派成績優良之員工，赴國內外實習或考察。
- C.選派成績優良之員工，修習與業務有關之課程。

(3)退休制度及其實施情形

- A.本公司訂有員工優退辦法。
- B.本公司依勞動基準法規定，成立勞工退休準備金監督委員會，訂有員工退休辦法，並依法令規定定期提撥勞工退休準備金並存入台灣銀行專戶儲存，由委員會負責退休準備金之管理及運用事宜。
- C.勞工退休金條例自 2005 年 7 月 1 日起施行，並採確定提撥制。實施後員工得選擇適用「勞動基準法」有關之退休金規定，或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前之工作年資。對適用該條例之員工，本公司每月負擔之員工退休金提撥率，不低於員工每月薪資百分之六。
- D.依中華民國財務會計準則第十八號公報規定，委請精算師對勞工退休準備金進行評估計算，並提出精算評估報告。

(4)勞資間之協議情形：

本公司一切依照勞動法令之相關規定、勞資雙方依據聘僱合約、工作規則及各項管理規章辦理；本公司勞資關係和諧，並無重大勞資糾紛及損失之發生。未來仍將持續加強勞資雙方之溝通協調，並盡力做好福利措施，促使勞資關係更加和諧，以期消弭勞資糾紛發生之可能。

另外，本公司亦依據勞動基準法第八十三條規定，定期召開勞資會議。有關任何勞資關係措施，均經勞資雙方充分協議溝通，故尚無重大勞資爭議情事發生。

(5)各項員工權益維護措施情形

- A.本公司相當重視員工各項福利及雙向溝通管道，訂有完善之文管系統，載明各項管理辦法，內容明訂員工權利義務及福利項目，以維護員工權益。
- B.人員安全方面，依職業安全衛生法規定,新進同仁於報到當天進行公司內部作業危害告知及有關規定，以求新進同仁了解公司環境及危害。
- C.機械、器具安全方面，依法令細則規定，各式機器、器具均有合格維護廠商進行維護，其操作同仁均有合格操作證（照）書。
- D.環境安全方面，依法令規定每半年進行環境監測，並將監測結果公佈於公司網站及公佈欄週知，如有任何環境危害發生，將依監測顧問公司進行改善作業。
- E.本公司每年參加社團法人中華民國工業安全衛生協會依照「事業單位無災害工時紀錄活動實施要點」規定辦理之無災害工時紀錄活動，並且皆已取得證書公告在本公司官網。
- F. 本公司盡最大努力配合推展安全衛生工作，以保障全體員工之安全與衛生，並以確實的行動防制職業災害的發生，同時亦要求所屬員工共同參與安全衛生工

- 作，以建立良好的工作環境。本公司 2024 年已舉辦相關勞安與職場安全講習共 20 場，參與人數約 122 人次，其中包含每年至少兩次之消防演練；健康教育講座共 47 場，參與人數約 369 人次、健康教育資訊宣導總共 13,173 人次。
- G. 本公司通過安心作業場所之認證、取得國建署之健康啟動認證與企業運動認證...等，並且於 2023 年成為康健雜誌「CHR 健康企業公民」許諾企業。
- H. 本公司長期關注員工職場友善環境，在女性員工任用上，截至 2024 年女性員工占員工總人數達 22.82%，而女性擔任管理階層的比例也佔 14.6%。在政策上，本公司制訂「工作規則」、「性騷擾防治」、「招募任用管理」等內部辦法，針對工時、假勤、性別等明確宣示保護員工權利，確保同仁獲得妥善照顧；針對懷孕員工，除定期追蹤、健康諮詢，也提供孕婦專屬停車位，給予懷孕員工充分照顧；針對有哺乳需求之員工，亦設有哺乳室。本公司致力於創造兩性友善工作環境，以多元化和包容性的工作場所，讓女性在職場也能充分發為所長。本公司 2024 年已進行防治職場性騷擾宣導，共計數約 298 人次。

2. 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

六、資通安全管理：

1. 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

(1) 資通安全管理策略與架構

保護公司智慧財產及防止客戶機密資料外洩，是公司對於夥伴、股東及客戶的承諾，推行管理控制與稽核管控，對於資通訊規範程序依據程序、作業指導及表格文件管理管制。

組織分工藉由資安管控、資訊系統建置及資安稽核小組推動資安管制，落實公司智慧財產電子文件的保護及防止客戶所交付和公司研發的機密資料外漏。

客戶及供應商(外部供應鏈協同作業廠商)皆能放心並在信任之下委託，取得雙贏並增加商機。

資安防護藉由防火牆阻擋外來、內部入侵並與掃毒系統(企業級防毒軟體)管制監控並阻斷惡意封包，使得網路上的資訊設備及位於內網之機台皆能受到資安防護，透過資安設備系統事件記錄和報表，掌握網路、流量及掃毒(文件及垃圾郵件)等現況，文件誤刪亦能藉由資料備份系統予以還原。

資訊安全計畫推動採行三面向，即策略、管理及技術面，以流程構面為管理項目來掌控目標範圍。資安管理工作採行 PDCA 推動措施，即規劃、執行、檢查、行動來做為內部稽核控制方法與檢核。

專責小組

資安管控：硬體防護組、軟體防護組

資安建置：網路組、系統組

資安稽核：稽核組、改善組

(2) 管理方案與投入資源

資安管理防護方案在於以資安系統對於公司內部的電子資料文件予以加密保護避免招受有心人士的破壞與資料被竊取而外漏，購買軟硬體設備及教育訓練投入的資源如下：

- A. 公司資訊設備的硬體均受到網路防火牆及端點安全防護軟體及防毒軟體保護，使得置於其上的電子文件得以保全，防止智慧財產流入競爭者手中的保全政策能使客戶及協力廠商更加信任，造成雙贏取得更多的商業合作機會。
- B. 電子郵件社交工程演練，提升對惡意電子郵件之資安意識，非公務相關的垃圾郵件提高警覺，避免“開啟附檔”或“點選連結”進而讓電腦被植入惡意程式造成危害。
- C. 內部員工資訊教育訓練，強化資安思維，對於所接觸的公司資料及使用的資訊設備皆能有危機意識。

2. 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無重大資通安全事故發生。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
土地租賃合約	台灣糖業(股)公司	2011.10~2055.01	承租燕巢區興龍段555、556等地號8筆土地計17,715.5平方公尺之地上權	無
土地租賃合約	南部科學工業園區管理局	2022.12.08~2042.12.31	橋頭科學工業園區廠房用地租約	無

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
融資合約	合庫銀行	2021.12.14~2041.12.14	中長期抵押擔保借款	廠房(3 廠)
		2022.01.14~2029.01.14		廠房及附屬設備(3 廠)
		2022.01.14~2027.01.14		廠房(2 廠)
橋科廠房新建工程合約	銓興營造	2024.05.16 起 630 日曆天期限完成	鈦昇科技橋科廠房新建工程	無
橋科廠房新建工程合約	天瀚工程	2024.05.02 起按雙方約定之進度日期執行	鈦昇科技橋科廠房水電空調工程	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

最近二年度財務狀況比較分析

單位：新臺幣仟元

項目	年度	2024 年度	2023 年度	差異	
				金額	%
流動資產		2,615,739	3,081,942	(466,203)	(15)
不動產、廠房及設備		1,259,492	750,964	508,528	68
使用權資產		165,523	177,928	(12,405)	(7)
無形資產		13,739	16,668	(2,929)	(18)
其他資產		147,231	131,257	15,974	12
資產總額		4,201,724	4,158,759	42,965	1
流動負債		495,565	546,050	(50,485)	(9)
非流動負債		876,422	1,263,337	(386,915)	(31)
負債總額		1,371,987	1,809,387	(437,400)	(24)
股本		1,083,769	985,954	97,815	10
資本公積		1,734,570	1,237,824	496,746	40
保留盈餘		165,045	279,600	(114,555)	(41)
其他權益		(2,704)	(31,456)	28,752	91
庫藏股票		(166,725)	(166,725)	0	0
歸屬於母公司業主之權益		2,813,955	2,305,197	508,758	22
非控制權益		15,782	44,175	(28,393)	(64)
權益總額		2,635,819	2,349,372	(286,447)	(11)

最近二年度變動達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一仟萬元以上者：

1. 不動產、廠房及設備增加:主係因子公司江蘇鈦晟新建廠房在建工程增加及完工所致。
2. 非流動負債、負債總額減少:主係因第三次無擔保轉換公司債轉換普通股所致。
3. 資本公積、歸屬於母公司業主之權益、權益總額增加:主係因股票發行溢價增加(公司債轉換普通股)所致。
4. 保留盈餘減少:主係2024年營業利益由盈轉虧所致。
5. 其他權益增加:主係受匯率波動使國外營運機構財務報表換算之兌換差額由負轉正所致。
6. 非控制權益減少:主係2024年子公司蘇州鈦升精密設備有限公司辦理清算所致。

二、財務績效

(一)最近二年度經營結果分析

單位：新臺幣仟元

項目	年度	2024 年度	2023 年度	增(減)金額	變動比例(%)
----	----	---------	---------	--------	---------

營業收入淨額	1,644,908	1,549,374	95,534	6
營業成本	1,047,264	935,093	112,171	12
營業毛利	597,644	614,281	(16,637)	(3)
營業費用	716,583	597,453	119,130	20
營業淨利	(118,939)	16,828	(135,767)	(807)
營業外收入及支出	65,593	21,487	44,106	205
繼續營業部門稅前淨利	(53,346)	38,315	(91,661)	(239)
所得稅(費用)利益	(5,513)	(14,740)	(9,227)	(63)
繼續營業部門稅後淨利	(58,859)	23,575	(82,434)	(350)
最近二年度變動達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一仟萬元以上者：				
1. 營業費用增加:主係因江蘇鈦晟新建廠房完工，提列折舊費用增加；及為提升競爭力，增加研發支出所致。				
2. 營業淨利減少:主係因營業毛利減少,且營業費用增加(如上述1.之說明),所致。				
3. 營業外收入及支出增加:主係受匯率波動影響產生淨外幣兌換利益所致。				
4. 繼續營業部門稅前淨利減少:主係因營業利益由盈轉虧所致。				
5. 所得稅費用減少:同上述4.之說明。				
6. 繼續營業部門稅後淨利減少:同上述4.之說明。				

(二) 預期銷售數量與其依據：

因本公司未編列財務預測，故不予以預測營業額。整體而言係依據產業環境、客戶產品與產能需求、市場供需、競爭狀況而定。

(三) 對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

本公司將持續開發高階新產品及降低生產成本，以挹注整體營收及獲利之提升。此外，本公司為因應未來財務業務之可能影響，將依照整體營運目標，訂定發展策略及經營方針，並確實執行計畫以達成目標。

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新臺幣仟元

項目	年度	2024 年度	2023 年度	增(減)變動比率	
				金額	%
營業活動之淨現金流入(流出)		355,267	246,422	108,845	44
投資活動之淨現金流入(流出)		(494,247)	(191,857)	(302,390)	(158)
籌資活動之淨現金流入(流出)		22,960	(272,100)	295,060	108
最近年度現金流量變動之主要原因：					
1. 營業活動淨現金流入增加:主係因2024年度應付帳款及其他應付款增加所致。					
2. 投資活動淨現金流出增加:主係因子公司江蘇鈦晟及本公司橋科廠在建工程增加所致。					
3. 籌資活動淨現金流入增加:主係因子公司江蘇鈦晟舉借長期借款所致。					

(二) 流動性不足之改善計畫：無。

(三)未來一年現金流動性分析

期初現金餘額(1)	全年來自營業活動淨現金流量(2)	全年來自投資活動及籌資活動淨現金流量(3)	現金剩餘(不足)數額(1)+(2)+(3)	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	融資計劃
730,387	200,000	(500,000)	430,387	-	-
1.未來一年度現金流量變動情形分析； (1)營業活動：主要係預計本公司營業所產生之淨現金流入。 (2)投資活動：主要用於橋頭科學園區新建廠房及新設電漿切割代工線之資本支出。 (3)籌資活動：擬辦理銀行聯貸，用以充實營運資金。 2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：除以營業活動現金流入支應外，若於現金餘額不足時將以銀行借款支應。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

本公司近年度之重大資本支出，主要係子公司江蘇鈦晟和橋科廠之新建廠房，新增電漿切割代工線之資本支出為主。資金來源主要係以發行可轉換公司債及銀行提供之借款額度支應。本公司因應長期業務發展需求，擴充產能，以提升公司中長期競爭力，對公司財務業務及營運長遠規劃應有正面助益。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃

1.最近年度轉投資政策

本公司經營管理階層基於營運需求或公司未來成長之考量等因素進行轉投資，主要為長期策略投資，並擬定投資計畫，就投資標的之組織型態、投資目的、市場狀況、業務發展、可能合資對象、持股比例、參考價格及財務狀況等項目進行詳細評估。此外，本公司針對已投資之事業亦隨時掌握被投資事業經營狀況，分析投資成效，以利管理階層作為投資後管理之追蹤評估。

2.轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計畫

單位：新臺幣仟元

轉投資公司	被投資公司本期(損)益	轉投資政策	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
唐威科技(股)公司	(12,734)	主營軟性電路板製造加工買賣業務	主要係軟板產業營業環境不佳而產生虧損。	積極開發新客戶及降低營運成本
鈦昇半導體材料有限公司	(23,505)	轉投資東莞鈦昇半導體材料公司，從事SMD包材產銷業務	主要係轉投資公司接單量不足以支應營運支出，致產生虧損。	加強大陸市場開發及降低營運成本
ENRICHMENT TECH.CO.	2,298	轉投資辰鈦貿易(上海)公司及無錫鈦昇半導體材料科技公司	主要係辰鈦貿易(上海)公司銷售設備零件部品獲利。	無
Excellent International Holding Limited	(77,662)	轉投資江蘇鈦晟半導體科技有限公司	轉投資公司新建廠房剛完工，尚處於營運初期階段。	加強大陸市場開發

3.未來一年投資計畫：將視集團經營策略，依據營運需求作評估。

六、風險事項分析評估

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

(1)利率變動

本公司之資金規劃以穩建為原則，資金配置上首重安全之管理，考量公司未來發展，除持續與銀行間保持良好關係爭取較優惠利率外，亦將考量不同資金來源之成本，選擇適當籌資方式來因應成長所需；惟目前利率維持低檔對本公司影響不大。

(2)匯率變動

本公司以外幣交易主要係外銷貨物、進口原物料所產生，目前對匯率採自然避險政策。考量匯率近年來波動較大，財務部適時蒐集往來銀行資訊，密切注意匯率變化，於必要時採取較積極的避險方式，以降低匯率變動對本公司之影響。

(3)通貨膨脹

本公司並無因受通貨膨脹而有重大影響之情形。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

- 1.本公司各項投資皆經審慎評估，並且依據「取得或處分資產處理程序」暨核決權限辦理，截至年報刊印日止並無從事高風險、高槓桿之投資。
- 2.因營運需要而對子公司進行之資金融通及背書保證，均依本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」規定辦理，並依法令規定及時且正確公告各項資訊。
- 3.衍生性商品之交易政策係依照公司「取得或處分資產處理程序」執行，本公司衍生性商品交易向來採保守態度操作且係以避險為目的，而非以獲利為考量。故視需要針對外幣部位變化進行避險調節，主要選擇遠期外匯為避險工具，然上述操作仍可能因匯率的波動造成交易本身之損失。本公司已依法令規定即時且正確的公告各項交易資訊。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司之自動化設備，係以雷射應用為核心技術。為確保公司研發能力的長期優勢及提升競爭力，不斷地大量投入研發經費，長期且積極網羅優秀的研發人才，落實訓練與栽培，以提升公司研發實力，提高技術門檻，拉大同業競爭距離，因此公司研發策略如下：

1. 充分了解市場與客戶需求，以其滿意度為主軸，並由與客戶共同開發新產品，以切合客戶之需求，提供客戶品質與效能更佳之產品。
2. 本公司長期培養的研發專業人員，進行研發績效評估與獎勵制度，留任並爭取優秀人才以提升研發部門的實力。本公司預計未來一年研發費用仍會維持在營

業收入淨額的 5%~10%。

3.充分與研究機構及學術單位互動，向各專家學者請益，累積公司研發實力。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司日常營運均依循國內、外相關法令規範辦理，並隨時注意國內、外政經發展趨勢及法令變動情形，以隨時調整營運策略。最近年度及截至年報刊印日止並未受到國內、外重要政策及法律變動而有影響公司財務及業務之情形。

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司持續投入資源於研發新技術及新產品，以配合業務單位之市場開發，業務單位隨時自市場上收集新資訊並與研發人員配合開發符合客戶需求之設備。最近年度及截至年報刊印日止科技改變及產業變化對本公司財務業務並無重大影響。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司自成立以來，積極強化內部管理，專注本業經營，並致力維持公司形象，遵守相關法令規定。對於危機處理及各項異常之應變，本公司均於第一時間予以掌控，以消弭潛在的風險。最近年度及截至年報刊印日止，並未發生因企業形象改變對企業危機管理之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無進行併購計畫之情事，惟將來若有併購計畫時，將秉持審慎評估之態度，充分考量併購之綜效，以確保公司利益及股東權益。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司基於因應所屬產業市場成長需求擴大營運規模，以提升其競爭力及市場占有率，並配合中長期營運發展需求建置整體運用空間，以提升整體營運績效及管理效能，且為提升營運之穩定性而以自建廠房取代租用廠房，同時響應政府近期推動「歡迎台商回台投資行動方案」政策，為利於公司永續經營及厚實公司產業競爭力，而計畫於橋頭科學園區興建自有廠房大樓，擬投入640,000千元用於支應興建廠房之土木營造、機電及廠務等工程款，其中地上一、二樓層係規劃成立精密型設備組裝區，用於生產半導體高階製程-晶圓雷射打印設備等相關雷射設備、晶圓級封裝雷射加工設備及晶圓級封裝電漿加工設備，提供未來彈性生產空間，以因應半導體設備市場之需求。預計2025年第四季正式啟用增加設備組裝機台生產空間後，預估可增加之產銷量、銷售值、營業毛利及營業利益如下表所示：

單位:台；新臺幣千元

年度	產品類別	數量	營業收入	銷貨成本	銷貨毛利	營業利益
2025	雷射相關設備	2	30,000	17,400	12,600	6,600
	電漿清洗設備	4	20,000	15,000	5,000	1,000
2026	雷射相關設備	28	420,000	230,000	190,000	106,000
	電漿清洗設備	16	80,000	60,000	20,000	4,000
2027	雷射相關設備	45	675,000	364,500	310,500	175,500
	電漿清洗設備	25	125,000	92,500	32,500	7,500
2028	雷射相關設備	45	675,000	364,500	310,500	175,500
	電漿清洗設備	25	125,000	92,500	32,500	7,500
2029	雷射相關設備	45	675,000	364,500	310,500	175,500
	電漿清洗設備	25	125,000	92,500	32,500	7,500
合計		260	2,950,000	1,693,400	1,256,600	666,600

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1. 進貨集中風險

本公司與各供應商間往來行之有年，除維持良好之合作關係外，供貨來源尚屬穩定，且未有供貨短缺或中斷致影響生產作業之情事。本公司並持續進行各種相關可行性評估，考量品質、產品良率、交期及供貨穩定性等條件，積極尋找新供應商，以避免產生進貨集中之風險。

2. 銷貨集中風險

本公司設備產品銷售範圍涵蓋半導體、封測及 LED 等產業。本公司將盡力維持現有良好客戶關係並積極開發新產品及拓展新客戶，分散產品結構，以擴展不同產品別客戶及訂單。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施： 無。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司經營團隊均致力於公司之永續發展，最近年度及截至年報刊印日止，並無經營權改變之情事。

(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：不適用。

(十三) 資安風險評估分析及其因應措施：

網際網路日益發達，網路安全的威脅也日益升高，本公司建構一套完整的資訊安全防護系統，以確保公司營運、財會等相關重要系統能有效運作。本公司

亦訂定有關使用電腦化資訊系統處理之相關作業辦法，以落實內部控制制度與維護資訊安全政策。

本公司電子資訊安全政策之目標：

- 1.訂有資訊安全管理辦法，不定期向所有同仁宣導資訊安全重要性。
- 2.尊重智慧財產權，保護供應商、客戶及公司資訊。
- 3.防範電腦病毒侵襲。
- 4.確保所有資訊安全意外事故或可疑之安全弱點，都應依循適當之通報機制向上反應，並適當調查及處理。
- 5.符合相關法令或法規之要求，達成業務持續運作之目標。

以上措施尚能有效保障公司資訊安全，防止不當的存取與駭客入侵。2024 年度及截至年報刊印日止，本公司雖曾有網路安全威脅事件，但因資料庫與資訊系統已妥善備份且及時復原，並未對本公司的財務業務產生重大之影響，除此之外，未有任何與此有關的法律案件或監管調查。本公司將會持續加強資訊安全的防護，添購相關資訊設備，以落實內部控制制度與維護資訊安全政策。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

- 一、關係企業相關資料：請詳公開資訊觀測站
(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)，輸入公司代號及年度。
- 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。
- 三、其他必要補充說明事項：無。
- 四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

鈦昇科技股份有限公司



董事長：王明慶

